

(19)日本国特許庁(JP)

(12)特許公報(B2)

(11)特許番号
特許第7585918号
(P7585918)

(45)発行日 令和6年11月19日(2024.11.19)

(24)登録日 令和6年11月11日(2024.11.11)

(51)国際特許分類

F I

B 4 1 J 2/14 (2006.01)

B 4 1 J 2/175(2006.01)

B 4 1 J 2/14

B 4 1 J 2/175 1 1 1

B 4 1 J 2/14 6 0 5

請求項の数 22 (全30頁)

(21)出願番号	特願2021-49385(P2021-49385)	(73)特許権者	000002369
(22)出願日	令和3年3月24日(2021.3.24)		セイコーエプソン株式会社
(65)公開番号	特開2022-147916(P2022-147916 A)	(74)代理人	東京都新宿区新宿四丁目1番6号 110003177
(43)公開日	令和4年10月6日(2022.10.6)		弁理士法人旺知国際特許事務所
審査請求日	令和6年2月8日(2024.2.8)	(72)発明者	鐘ヶ江 貴公
			長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内
		(72)発明者	大久保 勝弘
			長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内
		(72)発明者	村上 健太郎
			長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内
		(72)発明者	富松 慎吾
			最終頁に続く

(54)【発明の名称】 液体噴射ヘッドおよび液体噴射装置

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

液体を噴射する複数のノズルが設けられるノズル面を有する複数のヘッドチップと、
前記複数のヘッドチップを保持する熱伝導性のホルダーと、
前記複数のヘッドチップに供給される液体の流路が設けられる熱伝導性の流路構造体と、
前記ホルダーと前記流路構造体との間に配置され、前記ノズル面に平行な方向に沿う面
状のヒーターと、を備え、
前記ヒーターは、平面視で前記複数のヘッドチップに重なる、
ことを特徴とする液体噴射ヘッド。

【請求項2】

前記複数のヘッドチップはそれぞれ、前記ノズル面をそれぞれが有するノズル板を有す
る、
ことを特徴とする請求項1に記載の液体噴射ヘッド。

【請求項3】

前記流路構造体は、前記平面視で前記複数のヘッドチップに重なる、
ことを特徴とする請求項1又は2に記載の液体噴射ヘッド。

【請求項4】

前記ヒーターは、前記ホルダーの方を向く第1主面と、前記第1主面とは反対側を向く
面であって前記流路構造体の方を向く第2主面とを含み、
前記第1主面および第2主面のそれぞれが、前記平面視で前記複数のヘッドチップに重

なるように前記ノズル面と平行に配置されている、

ことを特徴とする請求項 1 乃至 3 のいずれか 1 項に記載の液体噴射ヘッド。

【請求項 5】

前記ヒーターは、前記第 1 主面および前記第 2 主面を接続する側面を含み、且つ、前記側面が前記ノズル面に直交するように配置され、

前記側面の表面積は、前記第 1 主面の表面積および前記第 2 主面の表面積のそれぞれよりも小さい、

ことを特徴とする請求項 4 に記載の液体噴射ヘッド。

【請求項 6】

前記ノズル面、前記第 1 主面および前記第 2 主面のそれぞれは、前記複数のヘッドチップ、前記ホルダー、前記ヒーターおよび前記流路構造体が積層される積層方向と直交する面である、

ことを特徴とする請求項 4 又は 5 に記載の液体噴射ヘッド。

【請求項 7】

前記ホルダーは、前記複数のヘッドチップを前記平面視で内包する保持部を有し、
前記ノズル面に沿って互いに交差する 2 つの方向を第 1 方向および第 2 方向とすると、
前記複数のヘッドチップのそれぞれは、前記第 1 方向に沿って長尺であり、
前記複数のヘッドチップは、第 1 ヘッドチップおよび第 2 ヘッドチップを含み、
前記第 1 ヘッドチップおよび前記第 2 ヘッドチップは、前記第 1 方向および前記第 2 方向の双方に互いにずれて配置され、

前記平面視で前記複数のヘッドチップの集合体に外接する仮想の長方形の 4 つの辺のうち、1 つの辺を第 1 辺とし、前記第 1 辺の一端に接続される辺を第 2 辺とし、前記第 1 辺の他端に接続される辺を第 3 辺としたとき、

前記第 1 ヘッドチップは、前記平面視で前記第 1 辺および前記第 3 辺に接し、

前記第 2 ヘッドチップは、前記平面視で前記第 2 辺に接し、

前記平面視で前記第 1 辺と前記第 2 辺と前記第 1 ヘッドチップと前記第 2 ヘッドチップとで囲まれる第 1 領域は、前記保持部の外縁よりも外側に位置する第 1 外側部分を含む、

ことを特徴とする請求項 1 乃至 6 のいずれか 1 項に記載の液体噴射ヘッド。

【請求項 8】

前記第 1 辺は、前記第 1 領域を画定する第 1 部分を有し、

前記第 2 辺は、前記第 1 領域を画定する第 2 部分を有し、

前記平面視で、前記保持部の前記外縁は、前記第 1 部分および前記第 2 部分の双方に交差する、

ことを特徴とする請求項 7 に記載の液体噴射ヘッド。

【請求項 9】

前記平面視で、前記保持部の前記外縁と前記第 1 部分との交点は、前記第 1 部分の midpoint よりも前記第 1 ヘッドチップの近くに位置し、かつ、前記保持部の前記外縁と前記第 2 部分との交点は、前記第 2 部分の midpoint よりも前記第 2 ヘッドチップの近くに位置する、

ことを特徴とする請求項 8 に記載の液体噴射ヘッド。

【請求項 10】

前記平面視での前記ホルダーの外形は、長方形または略長方形である、

ことを特徴とする請求項 7 から 9 のいずれか 1 項に記載の液体噴射ヘッド。

【請求項 11】

前記複数のヘッドチップを前記ホルダーに対して固定する固定板をさらに備え、

前記固定板は、前記ノズル面を露出させる開口部を有し、

前記平面視での前記固定板の外形は、長方形または略長方形である、

ことを特徴とする請求項 7 から 10 のいずれか 1 項に記載の液体噴射ヘッド。

【請求項 12】

前記平面視で、前記ヒーターおよび前記流路構造体のそれぞれは、前記第 1 外側部分に重なる、

10

20

30

40

50

ことを特徴とする請求項 7 から 11 のいずれか 1 項に記載の液体噴射ヘッド。

【請求項 13】

前記保持部と前記ヒーターとの間に配置され、前記ホルダーよりも熱伝導率の高い第 1 伝熱部材をさらに備え、

前記平面視で、前記第 1 伝熱部材は、前記第 1 外側部分に重なる、

ことを特徴とする請求項 7 から 12 のいずれか 1 項に記載の液体噴射ヘッド。

【請求項 14】

前記ホルダーには、前記複数のヘッドチップに供給される液体の流路が設けられ、

前記ホルダーは、金属またはセラミックスで構成される、

ことを特徴とする請求項 13 に記載の液体噴射ヘッド。

10

【請求項 15】

前記平面視で、前記第 1 領域は、前記ヒーターに重ならない部分を含む、

ことを特徴とする請求項 7 から 11 のいずれか 1 項に記載の液体噴射ヘッド。

【請求項 16】

前記ヒーターと前記流路構造体との間に配置され、前記流路構造体よりも熱伝導率の高い第 2 伝熱部材をさらに備え、

前記平面視で、前記第 2 伝熱部材および前記流路構造体のそれぞれは、前記第 1 外側部分に重なる、

ことを特徴とする請求項 15 に記載の液体噴射ヘッド。

【請求項 17】

20

前記流路構造体は、ステンレス鋼またはセラミックスで構成される、

ことを特徴とする請求項 16 に記載の液体噴射ヘッド。

【請求項 18】

前記複数のヘッドチップは、第 3 ヘッドチップおよび第 4 ヘッドチップを含み、

前記第 3 ヘッドチップおよび前記第 4 ヘッドチップは、前記第 1 方向および前記第 2 方向の双方に互いにずれて配置され、

前記仮想の長方形の 4 つの辺のうち、前記第 1 辺、前記第 2 辺および前記第 3 辺以外の辺を第 4 辺としたとき、

前記第 3 ヘッドチップは、前記平面視で前記第 3 辺に接し、

前記第 4 ヘッドチップは、前記平面視で前記第 2 辺および前記第 4 辺に接し、

30

前記平面視で前記第 3 辺と前記第 4 辺と前記第 3 ヘッドチップと前記第 4 ヘッドチップとで囲まれる第 2 領域は、前記保持部の前記外縁よりも外側に位置する第 2 外側部分を含む、

ことを特徴とする請求項 7 から 17 のいずれか 1 項に記載の液体噴射ヘッド。

【請求項 19】

前記第 1 領域の中心は、前記保持部の前記外縁の外側に位置する、

ことを特徴とする請求項 7 から 18 のいずれか 1 項に記載の液体噴射ヘッド。

【請求項 20】

前記第 1 外側部分の面積は、前記第 1 領域の面積の 1 / 4 以上である、

ことを特徴とする請求項 7 から 19 のいずれか 1 項に記載の液体噴射ヘッド。

40

【請求項 21】

前記ホルダーは、前記平面視で前記保持部との間に間隔を隔てて前記保持部を囲む外壁部を有する、

ことを特徴とする請求項 7 から 20 のいずれか 1 項に記載の液体噴射ヘッド。

【請求項 22】

請求項 1 から 21 のいずれか 1 項に記載の液体噴射ヘッドと、

前記液体噴射ヘッドに供給する液体を貯留する液体貯留部と、を備える、

液体噴射装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

50

【 0 0 0 1 】

本発明は、液体噴射ヘッドおよび液体噴射装置に関する。

【 背景技術 】

【 0 0 0 2 】

インクジェット方式のプリンターに代表される液体噴射装置には、一般に、インク等の液体を液滴として噴射する液体噴射ヘッドが設けられる。液体噴射ヘッドには、例えば、特許文献 1 に記載のインクジェットヘッドのように、液体を加熱するヒーターを設ける場合がある。

【 0 0 0 3 】

特許文献 1 に記載のプリントヘッドは、液体の流路を有する流路体と、流路体からの液体を吐出するヘッド本体と、2つのシート状のヒーターとを含む。ここで、流路体は、ヘッド本体とヒーターとの間に介在しており、ヒーターからの熱は、流路体を介してヘッド本体に伝達される。

10

【 先行技術文献 】

【 特許文献 】

【 0 0 0 4 】

【 文献 】 特開 2 0 1 0 - 7 6 1 7 6 号公報

【 発明の概要 】

【 発明が解決しようとする課題 】

【 0 0 0 5 】

特許文献 1 に記載のプリントヘッドでは、流路体がヘッド本体とヒーターとの間に介在するので、流路体の厚さに応じてヘッド本体とヒーターとの間の距離が長くなる。このため、特許文献 1 に記載のプリントヘッドでは、ヒーターとヘッド本体との間に温度勾配が生じやすく、この結果、ヘッド本体の温度を高精度に管理することが難しい。

20

【 課題を解決するための手段 】

【 0 0 0 6 】

以上の課題を解決するために、本発明の好適な態様に係る液体噴射ヘッドは、液体を噴射するノズルが設けられるノズル面を有する複数のヘッドチップと、前記複数のヘッドチップを保持する熱伝導性のホルダーと、前記複数のヘッドチップに供給される液体の流路が設けられる熱伝導性の流路構造体と、前記ホルダーと前記流路構造体との間に配置され、前記ノズル面に平行な方向に沿う面状のヒーターと、を備え、前記ヒーターは、平面視で前記複数のヘッドチップに重なる。

30

【 0 0 0 7 】

本発明の好適な態様に係る液体噴射装置は、前述の態様の液体噴射ヘッドと、前記液体噴射ヘッドに供給する液体を貯留する液体貯留部と、を備える。

【 図面の簡単な説明 】

【 0 0 0 8 】

【 図 1 】 第 1 実施形態に係る液体噴射装置の構成例を示す概略図である。

【 図 2 】 第 1 実施形態に係る液体噴射ヘッドおよび支持体の斜視図である。

【 図 3 】 第 1 実施形態に係る液体噴射ヘッドの分解斜視図である。

40

【 図 4 】 図 2 中の A - A 線断面図である。

【 図 5 】 図 2 中の B - B 線断面図である。

【 図 6 】 ヘッドチップの一例を示す断面図である。

【 図 7 】 第 1 実施形態におけるホルダーの下面図である。

【 図 8 】 第 1 実施形態におけるホルダーの上面図である。

【 図 9 】 第 1 実施形態におけるホルダーの保持部の形状を説明するための図である。

【 図 1 0 】 第 1 実施形態におけるヒーターおよび伝熱部材の形状を説明するための図である。

【 図 1 1 】 第 1 実施形態におけるヒーターからの熱の伝達経路を説明するための図である。

【 図 1 2 】 第 2 実施形態に係る液体噴射ヘッドの分解斜視図である。

50

【図 1 3】第 3 実施形態におけるヒーターからの熱の伝達経路を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】

【 0 0 0 9 】

以下、添付図面を参照しながら本発明に係る好適な実施形態を説明する。なお、図面において各部の寸法および縮尺は実際と適宜に異なり、理解を容易にするために模式的に示している部分もある。また、本発明の範囲は、以下の説明において特に本発明を限定する旨の記載がない限り、これらの形態に限られない。

【 0 0 1 0 】

以下の説明は、便宜上、互いに交差する X 軸、Y 軸および Z 軸を適宜に用いて行う。また、以下の説明では、X 軸に沿う一方向が X 1 方向であり、X 1 方向と反対の方向が X 2 方向である。同様に、Y 軸に沿って互いに反対の方向が Y 1 方向および Y 2 方向である。また、Z 軸に沿って互いに反対の方向が Z 1 方向および Z 2 方向である。また、Z 軸方向にみることを単に「平面視」という場合がある。なお、Y 方向または Y 2 方向は、「第 1 方向」の一例である。X 1 方向または X 2 方向は、「第 2 方向」の一例である。

【 0 0 1 1 】

ここで、典型的には、Z 軸が鉛直な軸であり、Z 2 方向が鉛直方向での下方向に相当する。ただし、Z 軸は、鉛直な軸でなくともよい。また、X 軸、Y 軸および Z 軸は、典型的には互いに直交するが、これに限定されず、例えば、80°以上100°以下の範囲内の角度で交差すればよい。

【 0 0 1 2 】

1. 第 1 実施形態

1 - 1. 液体噴射装置の概略構成

図 1 は、第 1 実施形態に係る液体噴射装置 100 の構成例を示す概略図である。液体噴射装置 100 は、「液体」の一例であるインクを液滴として媒体 M に噴射するインクジェット方式の印刷装置である。媒体 M は、典型的には印刷用紙である。なお、媒体 M は、印刷用紙に限定されず、例えば、樹脂フィルムまたは布帛等の任意の材質の印刷対象でもよい。

【 0 0 1 3 】

図 1 に示すように、液体噴射装置 100 は、液体貯留部 10 と制御ユニット 20 と搬送機構 30 と移動機構 40 と液体噴射ヘッド 50 とを有する。

【 0 0 1 4 】

液体貯留部 10 は、インクを貯留する容器である。液体貯留部 10 の具体的な態様としては、例えば、液体噴射装置 100 に着脱可能なカートリッジ、可撓性のフィルムで形成された袋状のインクパック、および、インクを補充可能なインクタンク等の容器が挙げられる。

【 0 0 1 5 】

図示しないが、液体貯留部 10 は、互いに種類の異なるインクを貯留する複数の容器を有する。当該複数の容器に貯留されるインクとしては、特に限定されないが、例えば、シアンインク、マゼンタインク、イエローインク、ブラックインク、クリアインク、ホワイトインクおよび処理液等が挙げられ、これらのうちの 2 種以上の組み合わせが用いられる。なお、インクの組成は、特に限定されず、例えば、染料または顔料等の色材を水系溶媒に溶解させた水系インクでもよいし、色材を有機溶剤に溶解させた溶剤系インクでもよいし、紫外線硬化型インクでもよい。

【 0 0 1 6 】

本実施形態では、互いに異なる 4 種類のインクが用いられる構成が例示される。当該 4 種類のインクは、例えば、シアンインク、マゼンタインク、イエローインクおよびブラックインクのような互いに色の異なるインクである。

【 0 0 1 7 】

制御ユニット 20 は、液体噴射装置 100 の各要素の動作を制御する。例えば、制御ユニット 20 は、CPU (Central Processing Unit) または FPGA (Field Programm

10

20

30

40

50

able Gate Array)等の処理回路と半導体メモリー等の記憶回路とを含む。制御ユニット20は、駆動信号Dおよび制御信号Sを液体噴射ヘッド50に向けて出力する。駆動信号Dは、液体噴射ヘッド50の駆動素子を駆動する駆動パルスを含む信号である。制御信号Sは、当該駆動素子に駆動信号Dを供給するか否かを指定する信号である。

【0018】

搬送機構30は、制御ユニット20による制御のもとで、媒体MをY1方向である搬送方向DMに搬送する。移動機構40は、制御ユニット20による制御のもとで、液体噴射ヘッド50をX1方向とX2方向とに往復させる。図1に示す例では、移動機構40は、液体噴射ヘッド50を収容するキャリッジと称される略箱型の支持体41と、支持体41が固定される搬送ベルト42と、を有する。なお、支持体41には、液体噴射ヘッド50のほかに、前述の液体貯留部10が搭載されてもよい。

10

【0019】

液体噴射ヘッド50は、後述するように複数のヘッドチップ54を有しており、制御ユニット20による制御のもとで、液体貯留部10から供給されるインクを各ヘッドチップ54の複数のノズルのそれぞれから媒体Mに向けて噴射方向であるZ2方向に噴射する。この噴射が搬送機構30による媒体Mの搬送と移動機構40による液体噴射ヘッド50の往復移動とに並行して行われることにより、媒体Mの表面にインクによる所定の画像が形成される。

【0020】

なお、液体貯留部10は、循環機構を介して液体噴射ヘッド50に接続されてもよい。当該循環機構は、液体噴射ヘッド50にインクを供給するとともに、液体噴射ヘッド50から排出されるインクを液体噴射ヘッド50への再供給のために回収する機構である。当該循環機構の動作により、インクの粘度上昇を抑えたり、インク内の気泡の滞留を低減したりすることができる。

20

【0021】

1-2. 液体噴射ヘッドの取付状態

図2は、第1実施形態に係る液体噴射ヘッド50および支持体41の斜視図である。図2に示すように、液体噴射ヘッド50は、支持体41に支持される。支持体41は、液体噴射ヘッド50を支持する部材であり、前述のように、本実施形態では、略箱状のキャリッジである。支持体41の構成材料としては、特に限定されないが、例えば、ステンレス鋼、アルミニウム、チタンまたはマグネシウム合金等の金属材料を用いることが好ましい。支持体41を金属材料で構成する場合、支持体41の剛性を高めやすいので、支持体41に対して液体噴射ヘッド50を安定的に支持することができる。また、この場合、支持体41が導電性を有するので、支持体41を介して液体噴射ヘッド50に基準電位を供給することができる。

30

【0022】

ここで、支持体41には、開口41aおよび複数のネジ孔41bが設けられる。本実施形態では、支持体41が板状の底部を有する略箱状をなしており、例えば、当該底部に開口41aおよび複数のネジ孔41bが設けられる。液体噴射ヘッド50は、開口41aに挿入された状態で、複数のネジ孔41bを用いたネジ止めにより支持体41に固定される。以上のように、液体噴射ヘッド50は、支持体41に対して取り付けられる。

40

【0023】

図2に示す例では、支持体41に取り付けられる液体噴射ヘッド50の数が1個である。なお、支持体41に取り付けられる液体噴射ヘッド50の数は、2個以上でもよい。この場合、支持体41には、例えば、当該数に応じた数または形状の開口41aが適宜に設けられる。

【0024】

1-3. 液体噴射ヘッドの構成

図3は、第1実施形態に係る液体噴射ヘッド50の分解斜視図である。図4は、図2中のA-A線断面図である。図5は、図2中のB-B線断面図である。なお、図3から図5

50

では、便宜上、液体噴射ヘッド50の各部が適宜に簡略的に示される。例えば、後述の図11に示すように、外壁部5bと流路構造体51との間には間隔d2の隙間が設けられるが、図4および図5では、作図の便宜上、当該隙間の図示が省略される。

【0025】

図3に示すように、液体噴射ヘッド50は、流路構造体51と基板ユニット52とホルダー53と4個のヘッドチップ54__1~54__4と固定板55とヒーター56と伝熱部材57とカバー58とを有する。これらは、Z2方向に向かって、カバー58、基板ユニット52、流路構造体51、伝熱部材57、ヒーター56、ホルダー53、4個のヘッドチップ54、固定板55の順に並ぶように配置される。以下、液体噴射ヘッド50の各部を順次説明する。

10

【0026】

なお、伝熱部材57は、「第2伝熱部材」の一例である。また、ヘッドチップ54__1~54__4のそれぞれは、図1に示すヘッドチップ54である。ここで、ヘッドチップ54__1は、「第1ヘッドチップ」の一例である。ヘッドチップ54__2は、「第2ヘッドチップ」の一例である。ヘッドチップ54__3は、「第3ヘッドチップ」の一例である。ヘッドチップ54__4は、「第4ヘッドチップ」の一例である。以下では、ヘッドチップ54__1~54__4を区別しない場合、これらのチップのそれぞれがヘッドチップ54と表記される。

【0027】

流路構造体51は、前述の液体貯留部10に貯留されたインクを4個のヘッドチップ54に供給するための流路が内部に設けられる構造体である。流路構造体51は、流路部材51aと8個の接続管51bとを有する。

20

【0028】

流路部材51aには、図示しないが、4種類のインクの種類ごとに設けられる4つの供給流路と、4種類のインクの種類ごとに設けられる4つの排出流路と、が設けられる。当該4つの供給流路のそれぞれは、インクの供給を受ける1つの導入口と、インクを排出する2つの排出口と、を有する。当該4つの排出流路のそれぞれは、インクの供給を受ける2つの導入口と、インクを排出する1つの排出口と、を有する。各供給流路の導入口および各排出流路の排出口のそれぞれは、流路部材51aのZ1方向を向く面に設けられる。これに対し、各供給流路の排出口および各排出流路の導入口のそれぞれは、流路部材51aのZ2方向を向く面に設けられる。

30

【0029】

また、流路部材51aには、複数の配線孔51cが設けられる。当該複数の配線孔51cのそれぞれは、ヘッドチップ54の後述の配線基板54iが基板ユニット52に向けて通される孔である。なお、流路部材51aの側面には、周方向での2箇所に切り欠いた部分が設けられる。当該部分による空間には、例えば、ヒーター56と基板ユニット52とを接続する図示しない配線等の部品が配置される。また、流路部材51aには、図示しない孔が設けられており、ホルダー53に対して当該孔を用いたネジ止めにより固定される。

【0030】

流路部材51aは、図示しないが、複数の基板をZ軸に沿う方向に積層した積層体で構成される。当該複数の基板のそれぞれには、前述の供給流路および排出流路のための溝および孔が適宜に設けられる。当該複数の基板は、例えば、接着剤、ろう付け、溶接またはネジ止め等により互いに接合される。なお、当該複数の基板の間には、必要に応じて、ゴム材料等で構成されるシート状のシール部材が適宜に配置されてもよい。また、流路部材51aを構成する基板の数または厚さ等は、供給流路および排出流路の形状等の態様に依りて決められ、特に限定されず、任意である。

40

【0031】

当該複数の基板のそれぞれの構成材料としては、熱伝導性の良好な材料を用いることが好ましく、例えば、室温(20)での熱伝導率が10.0W/m・K以上である、ステンレス鋼、チタンおよびマグネシウム合金等の金属材料、または、炭化ケイ素、窒化アル

50

ミニウム、サファイア、アルミナ、窒化珪素、サメットおよびイットリア等のセラミックス材料を用いることが好ましい。このような金属材料またはセラミックス材料を用いて流路部材 5 1 a を構成することにより、ヒーター 5 6 からの熱で流路部材 5 1 a 内のインクを効率的に加熱することができる。

【 0 0 3 2 】

8 個の接続管 5 1 b のそれぞれは、流路部材 5 1 a の Z 1 方向を向く面から突出する管体である。8 個の接続管 5 1 b は、前述の 4 つの供給流路と 4 つの排出流路とに対応しており、対応する供給流路の導入口または排出流路の排出口に接続される。各接続管 5 1 b の構成材料としては、特に限定されないが、例えば、ステンレス鋼、チタンおよびマグネシウム合金等の金属材料、または、炭化ケイ素、窒化アルミニウム、サファイア、アルミナ、窒化珪素、サメットおよびイットリア等のセラミックス材料を用いることが好ましい。

10

【 0 0 3 3 】

以上の 8 個の接続管 5 1 b のうち、前述の 4 つの供給流路に対応する 4 個の接続管 5 1 b には、互いに異なる種類のインクの供給を受けるよう、前述の液体貯留部 1 0 に接続される。一方、8 個の接続管 5 1 b のうち、前述の 4 つの排出流路に対応する 4 個の接続管 5 1 b は、液体噴射ヘッド 5 0 へのインクの初期充填時等の所定時にインクを排出するための排出容器または液体貯留部 1 0 と液体噴射ヘッド 5 0 との間に配置され液体を保持可能なサブタンク等に接続して用いられる。印刷時等の通常時には、前述の 4 つの排出流路に対応する 4 個の接続管 5 1 b は、キャップ等の封止体により塞がれる。なお、液体貯留部 1 0 が循環機構を介して液体噴射ヘッド 5 0 に接続される場合、4 つの排出流路に対応する 4 個の接続管 5 1 b は、通常時に、当該循環機構のインク回収用の流路に接続される。

20

【 0 0 3 4 】

基板ユニット 5 2 は、液体噴射ヘッド 5 0 を制御ユニット 2 0 に電氣的に接続するための実装部品を有するアセンブリである。基板ユニット 5 2 は、回路基板 5 2 a とコネクタ 5 2 b と支持板 5 2 c とを有する。

【 0 0 3 5 】

回路基板 5 2 a は、各ヘッドチップ 5 4 とコネクタ 5 2 b とを電氣的に接続するための配線を有するリジッド配線基板等のプリント配線基板である。回路基板 5 2 a は、支持板 5 2 c を介して流路構造体 5 1 上に配置されており、回路基板 5 2 a の Z 1 方向を向く面には、コネクタ 5 2 b が設置される。

30

【 0 0 3 6 】

コネクタ 5 2 b は、液体噴射ヘッド 5 0 と制御ユニット 2 0 とを電氣的に接続するための接続部品である。支持板 5 2 c は、回路基板 5 2 a を流路構造体 5 1 に対して取り付けるための板状の部材である。支持板 5 2 c の一方の面には、回路基板 5 2 a が載置されており、回路基板 5 2 a は、支持板 5 2 c に対してネジ止め等により固定される。また、支持板 5 2 c の他方の面は、流路構造体 5 1 に接触しており、その状態で、流路構造体 5 1 には、支持板 5 2 c がネジ止め等により固定される。

【 0 0 3 7 】

ここで、支持板 5 2 c は、前述のように回路基板 5 2 a を支持する機能だけでなく、回路基板 5 2 a と流路構造体 5 1 との間の電氣的な絶縁を確保したり、ヒーター 5 6 と回路基板 5 2 a との間を断熱したりする機能をも有する。これらの機能を好適に発揮させる観点から、支持板 5 2 c の構成材料は、絶縁性および断熱性に優れる材料であることが好ましく、具体的には、例えば、ザイロン等の変性ポリフェニレンエーテル樹脂、ポリフェニレンサルファイド樹脂、ポリプロピレン樹脂等の樹脂材料であることが好ましい。なお、ザイロンは、商標登録である。また、支持板 5 2 c の構成材料には、樹脂材料のほか、ガラス繊維等の繊維基材、またはアルミナ粒子等のフィラー等が含まれてもよい。

40

【 0 0 3 8 】

ホルダー 5 3 は、4 個のヘッドチップ 5 4 を収容および支持する構造体である。ホルダー 5 3 の構成材料としては、熱伝導性の良好な材料を用いることが好ましく、例えば、室

50

温（20）での熱伝導率が10.0 W/m・K以上である、ステンレス鋼、チタンおよびマグネシウム合金等の金属材料、または、炭化ケイ素、窒化アルミニウム、サファイア、アルミナ、窒化珪素、サメットおよびイットリア等のセラミックス材料を用いることが好ましい。このような金属材料またはセラミックス材料を用いてホルダー53を構成することにより、ヒーター56からの熱を、ホルダー53を介して各ヘッドチップ54に効率的に伝達することができる。

【0039】

ホルダー53は、略トレイ状をなしており、凹部53aと複数のインク孔53bと複数の配線孔53cと複数の凹部53dと複数のネジ孔53iと複数のネジ孔53kとを有する。凹部53aは、Z1方向に向けて開口しており、前述の流路部材51aとヒーター56と伝熱部材57との積層体が配置される空間である。当該複数のインク孔53bのそれぞれは、ヘッドチップ54と流路構造体51との間でインクを流通させる流路である。当該複数の配線孔53cのそれぞれは、ヘッドチップ54の配線基板54iが基板ユニット52に向けて通される孔である。当該複数の凹部53dのそれぞれは、Z2方向に向けて開口しており、ヘッドチップ54が配置される空間である。当該複数のネジ孔53iは、ホルダー53を支持体41に対してネジ止めするためのネジ孔である。当該複数のネジ孔53kは、ホルダー53に対してカバー58をネジ止めするためのネジ孔である。なお、ホルダー53の詳細については、後述の図7から図9に基づいて説明する。

10

【0040】

各ヘッドチップ54は、インクを噴射する。各ヘッドチップ54は、第1インクを噴射する複数のノズルと、第1インクとは異なる種類の第2インクを噴射する複数のノズルと、を有する。ここで、第1インクおよび第2インクは、前述の4種類のインクのうちの2種のインクである。例えば、ヘッドチップ54__1およびヘッドチップ54__2のそれぞれには、第1インクおよび第2インクとして当該4種類のインクのうちの2種のインクが用いられる。そして、ヘッドチップ54__3およびヘッドチップ54__4のそれぞれには、当該4種類のインクのうちの残りの2種のインクが用いられる。各ヘッドチップ54には、配線基板54iが設けられる。なお、図3では、各ヘッドチップ54の構成が簡略化して図示される。ヘッドチップ54の構成については、後述の図6に基づいて詳述する。

20

【0041】

固定板55は、4個のヘッドチップ54とホルダー53とが固定された板状部材である。具体的には、固定板55は、ホルダー53との間に4個のヘッドチップ54を挟む状態で配置され、各ヘッドチップ54およびホルダー53が接着剤等により固定される。

30

【0042】

固定板55には、4個のヘッドチップ54のノズル面FNを露出させる複数の開口部55aが設けられる。図3に示す例では、当該複数の開口部55aは、ヘッドチップ54ごとに個別に設けられる。固定板55は、例えば、ステンレス鋼、チタンおよびマグネシウム合金等の金属材料等で構成されており、ホルダー53から各ヘッドチップ54に熱を伝達する機能を有する。また、固定板55は導電性を有する。そのため、固定板55は、ホルダー53および支持体41を介して接地されており、媒体Mからの静電気等の影響を防ぐための静電シールドとしても機能する。なお、固定板55は、複数の金属材料から成る板状部材が積層されて構成されていてもよい。

40

【0043】

以上の固定板55の外形は、平面視で長方形または略長方形である。ここで、「略長方形」とは、実質的に長方形といえる形状と長方形に類似した形状とを含む概念である。実質的に長方形といえる形状は、例えば、長方形の4つの角部をC面取りまたはR面取り等の面取りにより得られる形状である。長方形に類似した形状は、例えば、長方形に沿う4つの辺と当該4つの辺のそれぞれよりも短い4つの辺とを含む八角形のような形状である。なお、開口部55aは、2個以上のヘッドチップ54で共用される態様でもよい。ただし、開口部55aがヘッドチップ54ごとに個別に設けられる場合、固定板55と各ヘッドチップ54との接触面積を大きくしやすいので、ホルダー53から各ヘッドチップ54

50

に熱を効率的に伝達することができる。

【 0 0 4 4 】

ヒーター 5 6 は、流路構造体 5 1 とホルダー 5 3 との間に配置される面状のヒーターである。ヒーター 5 6 は、例えば、絶縁性のフィルムと、薄膜状の発熱抵抗体と、を有するフィルムヒーターである。当該フィルムは、例えば、ポリイミドまたは P E T (ポリエチレンテレフタレート) 等の樹脂材料で構成される。当該発熱抵抗体は、当該フィルム上にパターンニングされ、例えば、ステンレス鋼や銅又はニッケル合金等の金属材料で構成される。また、ヒーター 5 6 は、ガラス繊維入りシリコンゴムの間に発熱体を挟んだシリコンラバーヒーターやセラミックヒーター等の面状のヒーターでもよい。

【 0 0 4 5 】

ヒーター 5 6 には、複数の孔 5 6 a と複数の孔 5 6 b とが設けられる。当該複数の孔 5 6 a のそれぞれは、ヘッドチップ 5 4 の配線基板 5 4 i と、ホルダー 5 3 に形成された流路管 5 3 l とが通される孔である。流路管 5 3 l の内部に形成されたインク孔 5 3 b は、ヘッドチップ 5 4 と流路構造体 5 1 との間でインクを流通させる流路の一部である。流路管 5 3 l は、例えば、ホルダー 5 3 の Z 1 方向を向く上面 (後述する第 1 面 F 1) から Z 1 方向へ突出する。そして、流路管 5 3 l の Z 1 方向側の先端が流路構造体の 5 1 の Z 2 方向を向く下面に接着されることで、インク孔 5 3 b は流路構造体 5 1 の内部の流路と液密にシールされている。当該複数の孔 5 6 b のそれぞれは、ヒーター 5 6 をホルダー 5 3 に対してネジ止めするための孔である。なお、ヒーター 5 6 の平面視形状については、後述の図 10 に基づいて詳述する。

【 0 0 4 6 】

伝熱部材 5 7 は、熱伝導性を有し、流路構造体 5 1 とヒーター 5 6 との間に配置される板状の部材である。伝熱部材 5 7 は、厚さ方向および面方向のそれぞれに熱を伝達する機能を有する。当該機能により、ヒーター 5 6 からの熱が伝熱部材 5 7 を介して流路構造体 5 1 に効率的に伝達される。ここで、伝熱部材 5 7 の面方向での伝熱により、ヒーター 5 6 の発熱分布に起因する流路構造体 5 1 の加熱ムラが低減される。

【 0 0 4 7 】

伝熱部材 5 7 は、例えば、金属材料または炭化ケイ素、窒化アルミニウム、サファイア、アルミナ、窒化珪素、サメットおよびイットリア等のセラミックスのような熱伝導性の材料で構成される。当該金属材料としては、例えば、ステンレス鋼、アルミニウム、チタンおよびマグネシウム合金等が挙げられる。伝熱部材 5 7 は、流路構造体 5 1 やホルダー 5 3 に対して熱伝導率が高い材料であるのが好ましい。このような熱伝導率の高い伝熱部材 5 7 を備えることにより、ヒーター 5 6 からの熱をノズル面 F N に平行な方向へ移動しやすくするため、ヒーター 5 6 からの熱が伝熱部材 5 7 を介して加熱対象物である流路構造体 5 1 に均一且つ効率的に伝達することができる。

【 0 0 4 8 】

伝熱部材 5 7 には、複数の孔 5 7 a と複数の配線孔 5 7 b と複数の孔 5 7 c とが設けられる。当該複数の孔 5 7 a のそれぞれは、前述の流路管 5 3 l が挿通される孔である。当該複数の配線孔 5 7 b のそれぞれは、ヘッドチップ 5 4 の配線基板 5 4 i が基板ユニット 5 2 に向けて通される孔である。当該複数の孔 5 7 c は、伝熱部材 5 7 をホルダー 5 3 に対してネジ止めするための孔である。本実施形態では、当該複数の孔 5 7 c のうちの 2 つの孔 5 7 c がヒーター 5 6 および伝熱部材 5 7 を共締めによりホルダー 5 3 に固定するのに用いられる。なお、伝熱部材 5 7 の平面視形状については、後述の図 10 に基づいて詳述する。

【 0 0 4 9 】

カバー 5 8 は、基板ユニット 5 2 を収容する箱状の部材である。カバー 5 8 は、例えば、前述の支持板 5 2 c と同様、変性ポリフェニレンエーテル樹脂、ポリフェニレンサルファイド樹脂、ポリプロピレン樹脂等の樹脂材料で構成される。

【 0 0 5 0 】

カバー 5 8 には、8 個の貫通孔 5 8 a と開口部 5 8 b とが設けられる。当該 8 個の貫通

10

20

30

40

50

孔 5 8 a は、流路構造体 5 1 の 8 個の接続管 5 1 b に対応しており、各貫通孔 5 8 a には、対応する接続管 5 1 b が挿入される。開口部 5 8 b には、カバー 5 8 の内側から外側に前述のコネクター 5 2 b が通される。

【 0 0 5 1 】

1 - 4 . ヘッドチップの構成

図 6 は、ヘッドチップ 5 4 の一例を示す断面図である。図 6 に示すように、ヘッドチップ 5 4 は、Y 軸に沿う方向に配列される複数のノズル N を有する。当該複数のノズル N は、X 軸に沿う方向に互いに間隔をあけて並ぶ第 1 列 L 1 と第 2 列 L 2 とに区分される。第 1 列 L 1 および第 2 列 L 2 のそれぞれは、Y 軸に沿う方向に直線状に配列される複数のノズル N の集合である。

10

【 0 0 5 2 】

ヘッドチップ 5 4 は、X 軸に沿う方向で互いに略対称な構成である。ただし、第 1 列 L 1 の複数のノズル N と第 2 列 L 2 の複数のノズル N との Y 軸に沿う方向での位置は、互いに一致してもよいし異なってもよい。図 6 では、第 1 列 L 1 の複数のノズル N と第 2 列 L 2 の複数のノズル N との Y 軸に沿う方向での位置が互いに一致する構成が例示される。

【 0 0 5 3 】

図 6 に示すように、ヘッドチップ 5 4 は、流路基板 5 4 a と圧力室基板 5 4 b とノズル板 5 4 c と吸振体 5 4 d と振動板 5 4 e と複数の圧電素子 5 4 f と保護板 5 4 g とケース 5 4 h と配線基板 5 4 i と駆動回路 5 4 j とを有する。

【 0 0 5 4 】

20

流路基板 5 4 a および圧力室基板 5 4 b は、この順で Z 1 方向に積層されており、複数のノズル N にインクを供給するための流路を形成する。流路基板 5 4 a および圧力室基板 5 4 b からなる積層体よりも Z 1 方向に位置する領域には、振動板 5 4 e と複数の圧電素子 5 4 f と保護板 5 4 g とケース 5 4 h と配線基板 5 4 i と駆動回路 5 4 j とが設置される。他方、当該積層体よりも Z 2 方向に位置する領域には、ノズル板 5 4 c と吸振体 5 4 d とが設置される。ヘッドチップ 5 4 の各要素は、概略的には Y 方向に長尺な板状部材であり、例えば接着剤により、互いに接合される。以下、ヘッドチップ 5 4 の各要素を順に説明する。

【 0 0 5 5 】

ノズル板 5 4 c は、第 1 列 L 1 および第 2 列 L 2 のそれぞれの複数のノズル N が設けられた板状部材である。複数のノズル N のそれぞれは、インクを通過させる貫通孔である。ここで、ノズル板 5 4 c の Z 2 方向を向く面がノズル面 F N である。つまり、ノズル面 F N の法線方向は、ノズル面 F N の法線ベクトルの方向であり、噴射方向である Z 2 方向である。ノズル板 5 4 c は、例えば、ドライエッチングまたはウェットエッチング等の加工技術を用いる半導体製造技術によりシリコン単結晶基板を加工することにより製造される。ただし、ノズル板 5 4 c の製造には、他の公知の方法および材料が適宜に用いられてもよい。また、ノズルの断面形状は、典型的には円形状であるが、これに限定されず、例えば、多角形または楕円形等の非円形状であってもよい。

30

【 0 0 5 6 】

流路基板 5 4 a には、第 1 列 L 1 および第 2 列 L 2 のそれぞれについて、空間 R 1 と複数の供給流路 R a と複数の連通流路 N a とが設けられる。空間 R 1 は、Z 軸に沿う方向でみた平面視で、Y 軸に沿う方向に延びる長尺状の開口である。供給流路 R a および連通流路 N a のそれぞれは、ノズル N ごとに形成された貫通孔である。各供給流路 R a は、空間 R 1 に連通する。

40

【 0 0 5 7 】

圧力室基板 5 4 b は、第 1 列 L 1 および第 2 列 L 2 のそれぞれについて、キャビティと称される複数の圧力室 C が設けられた板状部材である。複数の圧力室 C は、Y 軸に沿う方向に配列される。各圧力室 C は、ノズル N ごとに形成され、平面視で X 軸に沿う方向に延びる長尺状の空間である。流路基板 5 4 a および圧力室基板 5 4 b それぞれは、前述のノズル板 5 4 c と同様に、例えば、半導体製造技術によりシリコン単結晶基板を加工するこ

50

とにより製造される。ただし、流路基板 5 4 a および圧力室基板 5 4 b のそれぞれの製造には、他の公知の方法および材料が適宜に用いられてもよい。

【 0 0 5 8 】

圧力室 C は、流路基板 5 4 a と振動板 5 4 e との間に位置する空間である。第 1 列 L 1 および第 2 列 L 2 のそれぞれについて、複数の圧力室 C が Y 軸に沿う方向に配列される。また、圧力室 C は、連通流路 N a および供給流路 R a のそれぞれに連通する。したがって、圧力室 C は、連通流路 N a を介してノズル N に連通し、かつ、供給流路 R a を介して空間 R 1 に連通する。

【 0 0 5 9 】

圧力室基板 5 4 b の Z 1 方向を向く面には、振動板 5 4 e が配置される。振動板 5 4 e は、弾性的に振動可能な板状部材である。振動板 5 4 e は、例えば、第 1 層と第 2 層とを有し、これらがこの順で Z 1 方向に積層される。第 1 層は、例えば、酸化シリコン (SiO_2) で構成される弾性膜である。当該弾性膜は、例えば、シリコン単結晶基板の一方の面を熱酸化することにより形成される。第 2 層は、例えば、酸化ジルコニウム (ZrO_2) で構成される絶縁膜である。当該絶縁膜は、例えば、スパッタ法によりジルコニウムの層を形成し、当該層を熱酸化することにより形成される。なお、振動板 5 4 e は、前述の第 1 層および第 2 層の積層による構成に限定されず、例えば、単層で構成されてもよいし、3 層以上で構成されてもよい。

10

【 0 0 6 0 】

振動板 5 4 e の Z 1 方向を向く面には、第 1 列 L 1 および第 2 列 L 2 のそれぞれについて、互いにノズル N に対応する複数の圧電素子 5 4 f が駆動素子として配置される。各圧電素子 5 4 f は、駆動信号の供給により変形する受動素子である。各圧電素子 5 4 f は、平面視で X 軸に沿う方向に延びる長尺状をなす。複数の圧電素子 5 4 f は、複数の圧力室 C に対応するように Y 軸に沿う方向に配列される。圧電素子 5 4 f は、平面視で圧力室 C に重なる。

20

【 0 0 6 1 】

各圧電素子 5 4 f は、図示しないが、第 1 電極と圧電体層と第 2 電極とを有し、この順でこれらが Z 1 方向に積層される。第 1 電極および第 2 電極のうちの一方の電極は、圧電素子 5 4 f ごとに互いに離間して配置される個別電極であり、当該一方の電極には、駆動信号が印加される。第 1 電極および第 2 電極のうちの他方の電極は、複数の圧電素子 5 4 f にわたり連続するように Y 軸に沿う方向に延びる帯状の共通電極であり、当該他方の電極には、所定の基準電位が供給される。これらの電極の金属材料としては、例えば、白金 (Pt)、アルミニウム (Al)、ニッケル (Ni)、金 (Au)、銅 (Cu) 等の金属材料が挙げられ、これらのうち、1 種を単独でまたは 2 種以上を合金または積層等の態様で組み合わせて用いることができる。圧電体層は、チタン酸ジルコン酸鉛 ($\text{Pb}(\text{Zr}, \text{Ti})\text{O}_3$) 等の圧電材料で構成されており、例えば、複数の圧電素子 5 4 f にわたり連続するように Y 軸に沿う方向に延びる帯状をなす。ただし、圧電体層は、複数の圧電素子 5 4 f にわたり一体でもよい。この場合、圧電体層には、互いに隣り合う各圧力室 C の間隙に平面視で対応する領域に、当該圧電体層を貫通する貫通孔が X 軸に沿う方向に延びて設けられる。以上の圧電素子 5 4 f の変形に連動して振動板 5 4 e が振動すると、圧力室 C 内の圧力が変動することで、インクがノズル N から吐出される。なお、駆動素子として、当該圧電素子 5 4 f に代えて、圧力室 C 内のインクを加熱する発熱素子を用いてもよい。

30

40

【 0 0 6 2 】

保護板 5 4 g は、振動板 5 4 e の Z 1 方向を向く面に設置される板状部材であり、複数の圧電素子 5 4 f を保護するとともに振動板 5 4 e の機械的な強度を補強する。ここで、保護板 5 4 g と振動板 5 4 e との間には、複数の圧電素子 5 4 f が収容される。保護板 5 4 g は、例えば、樹脂材料で構成される。

【 0 0 6 3 】

ケース 5 4 h は、複数の圧力室 C に供給されるインクを貯留するためのケースである。ケース 5 4 h は、例えば、樹脂材料で構成される。ケース 5 4 h には、第 1 列 L 1 および

50

第2列L2のそれぞれについて、空間R2が設けられる。空間R2は、前述の空間R1に連通する空間であり、空間R1とともに、複数の圧力室Cに供給されるインクを貯留するリザーバーRとして機能する。ケース54hには、各リザーバーRにインクを供給するための導入口IOが設けられる。各リザーバーR内のインクは、各供給流路Raを介して圧力室Cに供給される。

【0064】

吸振体54dは、コンプライアンス基板とも称され、リザーバーRの壁面を構成する可撓性の樹脂フィルムであり、リザーバーR内のインクの圧力変動を吸収する。なお、吸振体54dは、金属製の可撓性を有する薄板であってもよい。吸振体54dのZ1方向を向く面は、流路基板54aに接着剤等により接合される。一方、吸振体54dのZ2方向を向く面には、枠体54kが接着剤等により接合される。枠体54kは、吸振体54dの外周に沿う枠状の部材であり、前述の固定板55に接触する。ここで、枠体54kは、例えば、ステンレス鋼、アルミニウム、チタンおよびマグネシウム合金等の金属材料で構成される。このように枠体54kを金属材料で構成することにより、ヒーター56からの熱をホルダー53および固定板55を介してヘッドチップ54内のインクに好適に伝達することができる。なお、図6には、ヒーター56からヘッドチップ54への熱の伝達経路H1が破線矢印で模式的に示される。なお、伝達経路H1の一部には、比較的熱伝導率が低い材料である樹脂製の吸振体54dを含むが、吸振体54dは可撓性を有するためにフィルム状で形成されることで厚さが薄く、熱抵抗は非常に小さいため。そのため、吸振体54dによって枠体54kから流路基板54aへの熱の伝導を阻害する影響は小さい。

【0065】

配線基板54iは、振動板54eのZ1方向を向く面に実装されており、制御ユニット20とヘッドチップ54とを電氣的に接続するための実装部品である。配線基板54iは、例えば、COF(Chip On Film)、FPC(Flexible Printed Circuit)またはFFC(Flexible Flat Cable)等の可撓性の配線基板である。本実施形態の配線基板54iには、各圧電素子54fに駆動電圧を供給するための駆動回路54jが実装される。駆動回路54jは、制御信号Sに基づいて、駆動信号Dに含まれる波形のうちの少なくとも一部を駆動パルスとして供給するか否かを切り替える回路である。

【0066】

1-5.ホルダーの構成

図7は、第1実施形態におけるホルダー53のZ1方向にみた下面図である。図8は、第1実施形態におけるホルダー53のZ2方向にみた上面図である。前述のように略トレイ状をなすホルダー53は、図7および図8に示すように、底部5aと外壁部5bとフランジ部5cとを有する。

【0067】

底部5aは、Z軸に直交する方向に広がる略板状をなしており、前述の凹部53aの底面を構成する。ここで、底部5aは、保持部5a1と、保持部5a1の外周を囲んで配置され、保持部5a1よりも厚さの薄い接続部5a2と、に区分される。

【0068】

保持部5a1は、前述の4つの凹部53dを有し、4個のヘッドチップ54を保持する。各ヘッドチップ54は、各凹部53dと固定板55との間で囲まれた空間内に收容されている。また、保持部5a1には、図7に示すように、4つの凹部53dのほか、2つの凹部53hが設けられる。各凹部53hは、いわゆる肉抜きのための凹部であり、4つの凹部53dの間に配置され、凹部53dと同程度の深さを有する。このような保持部5a1は、受熱部5a11と側壁部5a12と、を有する。

【0069】

受熱部5a11は、Z軸に直交する方向に広がる第1面F1および第2面F2を有する板状をなしており、凹部53dおよび凹部53hの底面を構成する。第1面F1は、Z1方向を向いており、ヒーター56からの熱を受ける受熱面である。第1面F1には、前述のヒーター56および伝熱部材57を介して流路構造体51が載置される。第2面F2は

、Z 2 方向を向いており、凹部 5 3 d および凹部 5 3 h の底面を構成する。

【 0 0 7 0 】

図 7 および図 8 に示す例では、受熱部 5 a 1 1 には、複数のインク孔 5 3 b および複数の配線孔 5 3 c が第 1 面 F 1 および第 2 面 F 2 のそれぞれに開口するように設けられる。また、受熱部 5 a 1 1 の第 1 面 F 1 には、これらのほか、複数の孔 5 3 e と複数の孔 5 3 f と複数のネジ孔 5 3 g とが設けられる。

【 0 0 7 1 】

複数の孔 5 3 e は、ヘッドチップ 5 4 に設けられる図示しない突起が挿入されることにより、ホルダー 5 3 に対するヘッドチップ 5 4 の位置決めに用いる孔である。複数の孔 5 3 f は、流路構造体 5 1、ヒーター 5 6 及び伝熱部材 5 7 の位置決めに用いる位置決めピンが挿入されるための孔である。複数のネジ孔 5 3 g は、伝熱部材 5 7 のネジ止めに用いるネジ孔である。複数のネジ孔 5 3 g は、流路構造体 5 1 のネジ止めに用いるネジ孔である。

10

【 0 0 7 2 】

側壁部 5 a 1 2 は、受熱部 5 a 1 1 から Z 2 方向に突出しており、凹部 5 3 d および凹部 5 3 h の側面を構成する。側壁部 5 a 1 2 の Z 2 方向での端には、接続部 5 a 2 が接続される。ここで、Z 軸に沿う方向にみて、側壁部 5 a 1 2 の形状は、受熱部 5 a 1 1 の形状から複数の凹部 5 3 d および複数の凹部 5 3 h の形状を除いた形状である。つまり、側壁部 5 a 1 2 は、Z 軸に沿う方向にみて、隣り合う複数の凹部 5 3 d の間の隔壁と、隣り合う凹部 5 3 d と凹部 5 3 h との間の隔壁と、複数の凹部 5 3 d 及び複数の凹部 5 3 h を囲む外周壁と、を含む。

20

【 0 0 7 3 】

接続部 5 a 2 は、Z 軸に沿う方向にみて保持部 5 a 1 を囲んで配置される。接続部 5 a 2 は、側壁部 5 a 1 2 から Z 軸に直交する方向に延びる板状をなしており、側壁部 5 a 1 2 と外壁部 5 b とを全周にわたり接続する。なお、接続部 5 a 2 は、欠損した部分を有する形状でもよいし、周方向に間隔を隔てて並ぶ複数の部分で構成されてもよい。

【 0 0 7 4 】

外壁部 5 b は、底部 5 a の周縁から全周にわたり Z 1 方向に延びる枠状をなしており、前述の凹部 5 3 a の側面を構成する。

【 0 0 7 5 】

30

フランジ部 5 c は、外壁部 5 b の Z 1 方向での端から外方に向けて Z 軸に直交する方向に突出する板状をなす。このように、フランジ部 5 c の内周縁には、外壁部 5 b を介して底部 5 a の接続部 5 a 2 の外周縁が接続される。図 7 および図 8 に示す例では、フランジ部 5 c は、平面視で長方形または略長方形をなす。したがって、平面視でのホルダー 5 3 の外形は、長方形または略長方形である。フランジ部 5 c には、前述の複数のネジ孔 5 3 i および複数のネジ孔 5 3 k のほか、複数の孔 5 3 j が設けられる。複数の孔 5 3 j は、支持体 4 1 に設けられる図示しない突起が挿入されることにより、支持体 4 1 に対するホルダー 5 3 の位置決めに用いる孔である。

【 0 0 7 6 】

1 - 6 . ホルダーの保持部の形状

40

図 9 は、第 1 実施形態におけるホルダー 5 3 の保持部 5 a 1 の形状を説明するための図である。図 9 では、説明の便宜上、Z 2 方向にみた保持部 5 a 1 と複数のヘッドチップ 5 4 とのそれぞれの外形が実線で示される。

【 0 0 7 7 】

図 9 に示すように、Z 軸に沿う方向にみた平面視で、保持部 5 a 1 の外縁 O E 1 は、ヘッドチップ 5 4 __ 1、5 4 __ 2、5 4 __ 3、5 4 __ 4 の配置に応じた形状をなす。すなわち、外縁 O E 1 は、平面視で、長方形の 4 つの角のうちの対角となる 1 対の角およびその近傍部分を略長方形に切り欠いたような形状をなす。以下、ヘッドチップ 5 4 __ 1、5 4 __ 2、5 4 __ 3、5 4 __ 4 の配置と保持部 5 a 1 の外縁 O E 1 の平面視形状とについて順に詳細に説明する。

50

【 0 0 7 8 】

図 9 に示すように、ヘッドチップ 5 4 __ 1、ヘッドチップ 5 4 __ 2、ヘッドチップ 5 4 __ 3 およびヘッドチップ 5 4 __ 4 は、平面視で、千鳥配置される。ヘッドチップ 5 4 __ 1 とヘッドチップ 5 4 __ 2 とは互いに隣り合い、ヘッドチップ 5 4 __ 2 とヘッドチップ 5 4 __ 3 とは互いに隣り合い、ヘッドチップ 5 4 __ 3 とヘッドチップ 5 4 __ 4 とは互いに隣り合っている。

【 0 0 7 9 】

具体的には、ヘッドチップ 5 4 __ 1、ヘッドチップ 5 4 __ 2、ヘッドチップ 5 4 __ 3 およびヘッドチップ 5 4 __ 4 は、この順で X 1 方向に並ぶ。ただし、ヘッドチップ 5 4 __ 1 およびヘッドチップ 5 4 __ 3 は、ヘッドチップ 5 4 __ 2 およびヘッドチップ 5 4 __ 4 に対して Y 1 方向にずれた位置に配置される。ここで、ヘッドチップ 5 4 __ 1 およびヘッドチップ 5 4 __ 3 は、Y 軸に沿う方向での互いの位置を揃えるように、X 軸に沿う方向に並んで配置される。同様に、ヘッドチップ 5 4 __ 2 およびヘッドチップ 5 4 __ 4 は、Y 軸に沿う方向での互いの位置を揃えるように、X 軸に沿う方向に並んで配置される。また、各ヘッドチップ 5 4 の平面視形状は、Y 軸に沿う方向に延びる長方形または略長方形である。

【 0 0 8 0 】

図 9 では、平面視で、前述のように配置されるヘッドチップ 5 4 __ 1、5 4 __ 2、5 4 __ 3、5 4 __ 4 の集合体に外接する仮想の長方形 V S が二点鎖線で示される。長方形 V S は、平面視で、当該集合体を内包する最小の長方形である。また、本実施形態において、複数のヘッドチップ 5 4 __ 1、5 4 __ 2、5 4 __ 3、5 4 __ 4 の夫々は、仮想の長方形 V S に接する。図 9 に示す例では、当該集合体は、平面視で 2 回対称な形状をなす。

【 0 0 8 1 】

保持部 5 a 1 の外縁 O E 1 は、長方形 V S の内側に位置する部分と外側に位置する部分とを有する。

【 0 0 8 2 】

ここで、長方形 V S の 4 つの辺を第 1 辺 E 1、第 2 辺 E 2、第 3 辺 E 3 および第 4 辺 E 4 とするとき、ヘッドチップ 5 4 __ 1 は、平面視で第 1 辺 E 1 および第 3 辺 E 3 に接する。ヘッドチップ 5 4 __ 2 は、平面視で第 2 辺 E 2 に接する。ヘッドチップ 5 4 __ 3 は、平面視で第 3 辺 E 3 に接する。ヘッドチップ 5 4 __ 4 は、平面視で第 2 辺 E 2 および第 4 辺 E 4 に接する。

【 0 0 8 3 】

ただし、第 1 辺 E 1 は、長方形 V S の 4 つの辺のうちの 1 つの辺である。第 2 辺 E 2 は、長方形 V S の 4 つの辺のうちの第 1 辺 E 1 の一端に接続される辺である。第 3 辺 E 3 は、長方形 V S の 4 つの辺のうちの第 1 辺 E 1 の他端に接続される辺である。第 4 辺 E 4 は、長方形 V S の 4 つの辺のうちの第 1 辺 E 1、第 2 辺 E 2 および第 3 辺 E 3 以外の辺である。

【 0 0 8 4 】

平面視で第 1 辺 E 1 と第 2 辺 E 2 とヘッドチップ 5 4 __ 1 とヘッドチップ 5 4 __ 2 とで囲まれる第 1 領域 R E 1 は、外縁 O E 1 により第 1 内側部分 R E 1 a と第 1 外側部分 R E 1 b とに二分される。第 1 内側部分 R E 1 a は、第 1 領域 R E 1 のうち外縁 O E 1 よりも内側に位置する部分である。第 1 外側部分 R E 1 b は、第 1 領域 R E 1 のうち外縁 O E 1 よりも外側に位置する部分である。なお、第 1 領域 R E 1 は、平面視で、第 1 辺 E 1 と、第 2 辺 E 2 と、ヘッドチップ 5 4 __ 1 の 2 つの短辺のうちヘッドチップ 5 4 __ 2 に近いほうの短辺に沿う直線と、ヘッドチップ 5 4 __ 2 の 2 つの長辺のうちヘッドチップ 5 4 __ 1 に近いほうの長辺に沿う直線とで囲まれる矩形状の領域である。

【 0 0 8 5 】

ここで、第 1 辺 E 1 は、第 1 領域 R E 1 を画定する第 1 部分 P A 1 を有する。第 1 部分 P A 1 は、長方形をなす第 1 領域 R E 1 の 4 つの辺のうち、第 1 辺 E 1 に属する辺である。第 2 辺 E 2 は、第 1 領域 R E 1 を画定する第 2 部分 P A 2 を有する。第 2 部分 P A 2 は、長方形をなす第 1 領域 R E 1 の 4 つの辺のうち、第 2 辺 E 2 に属する辺である。そして

、平面視で、保持部 5 a 1 の外縁 O E 1 は、第 1 部分 P A 1 および第 2 部分 P A 2 の双方に交差する。

【 0 0 8 6 】

また、平面視で、保持部 5 a 1 の外縁 O E 1 と第 1 部分 P A 1 との交点 I P a は、第 1 部分 P A 1 の中点 M P 1 よりもヘッドチップ 5 4 __ 1 の近くに位置し、かつ、保持部 5 a 1 の外縁 O E 1 と第 2 部分 P A 2 との交点 I P b は、第 2 部分 P A 2 の中点 M P 2 よりもヘッドチップ 5 4 __ 2 の近くに位置する。なお、図 9 に示す例では、交点 I P b は、中点 M P 2 に極めて近い位置にあるが、中点 M P 2 に対して X 1 方向に位置する。

【 0 0 8 7 】

さらに、第 1 領域 R E 1 の中心 C P は、平面視で保持部 5 a 1 の外縁 O E 1 の外側に位置する。すなわち、保持部 5 a 1 の外縁 O E 1 の内側には、第 1 領域 R E 1 の中心 C P が包含されない。なお、図 9 に示す例では、中心 C P は、外縁 O E 1 に極めて近い位置にあるが、外縁 O E 1 の外側に位置する。

10

【 0 0 8 8 】

以上の第 1 領域 R E 1 と同様、平面視で第 3 辺 E 3 と第 4 辺 E 4 とヘッドチップ 5 4 __ 3 とヘッドチップ 5 4 __ 4 とで囲まれる第 2 領域 R E 2 は、外縁 O E 1 により第 2 内側部分 R E 2 a と第 2 外側部分 R E 2 b とに区分される。第 2 内側部分 R E 2 a は、外縁 O E 1 よりも内側に位置する。第 2 外側部分 R E 2 b は、外縁 O E 1 よりも外側に位置する。なお、第 2 領域 R E 2 は、平面視で、第 3 辺 E 3 と、第 4 辺 E 4 と、ヘッドチップ 5 4 __ 3 の 2 つの長辺のうちヘッドチップ 5 4 __ 4 に近いほうの長辺に沿う直線と、ヘッドチップ 5 4 __ 4 の 2 つの短辺のうちヘッドチップ 5 4 __ 3 に近いほうの短辺に沿う直線とで囲まれる矩形状の領域である。

20

【 0 0 8 9 】

1 - 7 . ヒーターの形状

図 1 0 は、第 1 実施形態におけるヒーター 5 6 および伝熱部材 5 7 の形状を説明するための図である。図 1 0 では、説明の便宜上、Z 2 方向にみたヒーター 5 6 と複数のヘッドチップ 5 4 とのそれぞれの外形が実線で示される。また、図 1 0 では、Z 2 方向にみた流路構造体 5 1 または伝熱部材 5 7 の外形が破線で示される。

【 0 0 9 0 】

図 1 0 に示すように、Z 軸に沿う方向にみた平面視で、ヒーター 5 6 の外縁 O E 2 は、ヘッドチップ 5 4 __ 1、5 4 __ 2、5 4 __ 3、5 4 __ 4 の配置に応じた形状をなす。本実施形態では、外縁 O E 2 は、前述の図 8 に示すように、概略的には、前述の保持部 5 a 1 の外縁 O E 1 と同形状である。すなわち、外縁 O E 2 は、外縁 O E 1 に沿う形状であるといえる。以下、ヒーター 5 6 の外縁 O E 2 の平面視形状について順に詳細に説明する。

30

【 0 0 9 1 】

図 1 0 では、前述の仮想の長方形 V S が二点鎖線で示される。ヒーター 5 6 の外縁 O E 2 は、前述の保持部 5 a 1 の外縁 O E 1 と同様、長方形 V S の内側に位置する部分と外側に位置する部分とを有する。

【 0 0 9 2 】

平面視で第 1 領域 R E 1 は、外縁 O E 2 により第 1 内側部分 R E 1 c と第 1 外側部分 R E 1 d とに二分される。第 1 内側部分 R E 1 c は、第 1 領域 R E 1 のうち外縁 O E 2 よりも内側に位置する部分である。第 1 外側部分 R E 1 d は、第 1 領域 R E 1 のうち外縁 O E 2 よりも外側に位置する部分である。なお、本実施形態では、前述のように外縁 O E 2 が概略的に保持部 5 a 1 の外縁 O E 1 と同形状であることから、第 1 内側部分 R E 1 c が前述の第 1 内側部分 R E 1 a に略等しく、第 1 外側部分 R E 1 d が第 1 外側部分 R E 1 b に略等しい。

40

【 0 0 9 3 】

ここで、平面視で、ヒーター 5 6 の外縁 O E 2 は、複数のヘッドチップ 5 4 を内包し、かつ、第 1 部分 P A 1 および第 2 部分 P A 2 の双方に交差する。また、平面視で、ヒーター 5 6 の外縁 O E 2 と第 1 部分 P A 1 との交点 I P c は、第 1 部分 P A 1 の中点 M P 1 よ

50

りもヘッドチップ 5 4 __ 1 の近くに位置し、かつ、ヒーター 5 6 の外縁 O E 2 と第 2 部分 P A 2 との交点 I P d は、第 2 部分 P A 2 の中点 M P 2 よりもヘッドチップ 5 4 __ 2 の近くに位置する。なお、図 1 0 に示す例では、交点 I P d は、中点 M P 2 に極めて近い位置にあるが、中点 M P 2 に対して X 1 方向に位置する。

【 0 0 9 4 】

第 1 領域 R E 1 の中心 C P は、平面視で外縁 O E 2 の外側に位置する。すなわち、ヒーター 5 6 の外縁 O E 2 の内側には、第 1 領域 R E 1 の中心 C P が包含されない。なお、図 1 0 に示す例では、中心 C P は、外縁 O E 2 に極めて近い位置にあるが、外縁 O E 2 の外側に位置する。

【 0 0 9 5 】

以上の第 1 領域 R E 1 と同様、平面視で第 2 領域 R E 2 は、外縁 O E 2 により第 2 内側部分 R E 2 c と第 2 外側部分 R E 2 d とに区分される。第 2 内側部分 R E 2 c は、外縁 O E 2 よりも内側に位置する。第 2 外側部分 R E 2 d は、外縁 O E 2 よりも外側に位置する。なお、本実施形態では、第 2 内側部分 R E 2 c が前述の第 2 内側部分 R E 2 a に略等しく、第 2 外側部分 R E 2 d が第 2 外側部分 R E 2 b に略等しい。

【 0 0 9 6 】

これに対し、図 1 0 中の破線で示す伝熱部材 5 7 は、平面視で、ヘッドチップ 5 4 __ 1、5 4 __ 2、5 4 __ 3、5 4 __ 4 を内包するだけでなく、第 1 外側部分 R E 1 d および第 2 外側部分 R E 2 d のそれぞれの少なくとも一部に重なる。同様に、伝熱部材 5 7 は、図示しないが、平面視で、前述の図 9 に示す第 1 外側部分 R E 1 b および第 2 外側部分 R E 2 b のそれぞれの少なくとも一部に重なる。

【 0 0 9 7 】

ここで、伝熱部材 5 7 の平面視形状は、流路構造体 5 1 の平面視形状にほぼ等しい。このため、平面視で、流路構造体 5 1 は、第 1 外側部分 R E 1 d および第 2 外側部分 R E 2 d のそれぞれの少なくとも一部に重なる。同様に、流路構造体 5 1 は、図示しないが、平面視で、前述の図 9 に示す第 1 外側部分 R E 1 b および第 2 外側部分 R E 2 b のそれぞれの少なくとも一部に重なる。

【 0 0 9 8 】

1 - 8 . ヒーターからの熱の伝達経路

図 1 1 は、第 1 実施形態におけるヒーター 5 6 からの熱の伝達経路 H 1 および伝達経路 H 2 を説明するための図である。図 1 1 では、伝達経路 H 1 および伝達経路 H 2 のそれぞれが破線で模式的に示される。

【 0 0 9 9 】

前述のように、支持体 4 1 には、外壁部 5 b が挿入される開口 4 1 a が設けられる。一方、フランジ部 5 c は、ノズル面 F N の法線方向である Z 2 方向を向く取付面 5 c 1 を有する。そして、ホルダー 5 3 は、外壁部 5 b と支持体 4 1 との間に間隔 d 1 を隔てて外壁部 5 b を開口 4 1 a に挿入するとともに取付面 5 c 1 を支持体 4 1 に接触させた状態で支持体 4 1 に取り付けられる。

【 0 1 0 0 】

ヒーター 5 6 は、前述のように、伝達経路 H 1 で各ヘッドチップ 5 4 に熱を伝達させることにより、各ヘッドチップ 5 4 を加熱する。

【 0 1 0 1 】

しかし、ヒーター 5 6 からの熱の一部は、ホルダー 5 3 を介して支持体 4 1 に伝達されてしまう。すなわち、ヒーター 5 6 からの熱の一部は、各ヘッドチップ 5 4 の加熱に用いられずに、ホルダー 5 3 を介して支持体 4 1 に逃げてしまう。このような熱の逃げは、ヒーター 5 6 による各ヘッドチップ 5 4 の加熱効率の低下を招くだけでなく、各ヘッドチップ 5 4 内またはヘッドチップ 5 4 間の温度分布のバラツキの原因となる。

【 0 1 0 2 】

そこで、このような熱の逃げを低減するべく、ホルダー 5 3 は、ヒーター 5 6 から支持体 4 1 への熱の伝達経路 H 2 での熱抵抗を高める構成を有する。具体的には、ホルダー 5

10

20

30

40

50

3では、前述のように、側壁部5a12、接続部5a2および外壁部5bを介して、受熱部5a11とフランジ部5cとを接続する。

【0103】

伝達経路H2は、受熱部5a11、側壁部5a12、接続部5a2、外壁部5bおよびフランジ部5cにこの順で熱が伝達される経路である。前述のように、側壁部5a12および外壁部5bのそれぞれがZ軸に沿う方向に延びるのに対し、接続部5a2およびフランジ部5cのそれぞれがZ軸に交差する方向に延びる。このため、伝達経路H2は、図11に示すような断面でみたとき、受熱部5a11からフランジ部5cまでの間で少なくとも2箇所屈曲または湾曲する。図11では、伝達経路H2の屈曲または湾曲する2箇所が二点鎖線で囲まれる領域で示される。

10

【0104】

ここで、側壁部5a12の外周面は、外壁部5bの内周面に対して全域にわたり間隔d3を隔てて配置される。このため、側壁部5a12から外壁部5bへの熱の伝達は、これらの間で直接行われずに、接続部5a2を経由する。また、流路構造体51は、外壁部5bとの間に間隔d2を隔てて配置される。このため、受熱部5a11から外壁部5bへの熱の伝達は、流路構造体51を経由しない。

【0105】

以上の液体噴射ヘッド50は、前述のように、複数のヘッドチップ54と熱伝導性のホルダー53と熱伝導性の流路構造体51と面状のヒーター56とを備える。複数のヘッドチップ54のそれぞれは、「液体」の一例であるインクを噴射するノズルNが設けられるノズル面FNを有する。ホルダー53は、複数のヘッドチップ54を保持する。流路構造体51には、複数のヘッドチップ54に供給されるインクの流路が設けられる。ヒーター56は、ホルダー53と流路構造体51との間に配置され、ノズル面FNに平行な方向に沿う。そのうえで、ヒーター56は、平面視で複数のヘッドチップ54に重なる。

20

【0106】

以上の液体噴射ヘッド50では、ヒーター56がホルダー53と流路構造体51との間に配置される。このため、ヒーター56とホルダー53との間に流路構造体51が介在する従来の構成に比べて、ヒーター56からの熱をホルダー53および流路構造体51のそれぞれに効率的に伝達することができる。この結果、ホルダー53と流路構造体51との温度差を低減し、ひいては、ヘッドチップ54と流路構造体51との温度差を低減することができる。また、ヒーター56がノズル面に平行な方向に沿う面状をなしており、そのうえで、ヒーター56が平面視で複数のヘッドチップ54に重なる。このため、ヒーター56が平面視で複数のヘッドチップ54の一部のみ重なる構成に比べて、ヒーター56からの熱を複数のヘッドチップ54のそれぞれに効率的に伝達することができる。この結果、複数のヘッドチップ54間の温度差を低減することもできる。以上から、ヒーター56の温度制御によりヘッドチップ54の温度を高精度に管理することができる。

30

【0107】

本実施形態では、前述のように、ホルダー53は、複数のヘッドチップ54を保持する保持部5a1を有する。保持部5a1は、複数のヘッドチップ54を平面視で内包する。このため、ヒーター56からの熱を1つの保持部5a1を介して複数のヘッドチップ54に伝達することができる。この結果、ヒーター56をヘッドチップ54ごとに設ける必要がないので、ヒーター56の設置が容易である。

40

【0108】

そのうえで、複数のヘッドチップ54のそれぞれは、Y軸に沿う方向に沿って長尺である。また、複数のヘッドチップ54は、「第1ヘッドチップ」の一例であるヘッドチップ54_1と、「第2ヘッドチップ」の一例であるヘッドチップ54_2とを含む。ヘッドチップ54_1とヘッドチップ54_2とは、互いに隣り合う。ここで、複数のヘッドチップが隣り合うとは、複数のヘッドチップ54同士の位置関係のことを指しており、当該複数のヘッドチップ54の間にヘッドチップ54以外の構成（例えば、本実施形態ではホルダー53の5a12側壁部に相当）が介在していてもよい。また、ヘッドチップ54

50

__ 1 とヘッドチップ 5 4 __ 3 とは、ヘッドチップ 5 4 __ 2 の Y 1 方向の端部を介在するようにして、互いに X 軸に沿う方向にずれて且つ Y 軸に沿う方向に関して同じ位置に配置されている。しかし、ヘッドチップ 5 4 __ 1 とヘッドチップ 5 4 __ 3 とは、ヘッドチップ 5 4 の Y 軸に沿う方向に関する寸法の半分以上で互いに X 軸に沿う方向に対向する位置関係にある。そのため、これらのヘッドチップ 5 4 __ 1 およびヘッドチップ 5 4 __ 3 も、互いに隣り合う関係にあると言える。そして、ヘッドチップ 5 4 __ 1 およびヘッドチップ 5 4 __ 2 は、Y 軸に沿う方向および X 軸に沿う方向の双方に互いにずれて配置される。なお、ノズル面 F N に沿って互いに交差する 2 つの方向を第 1 方向および第 2 方向とすると、Y 軸に沿う方向が「第 1 方向」の一例であり、X 軸に沿う方向が「第 2 方向」の一例である。

10

【 0 1 0 9 】

ここで、ヘッドチップ 5 4 __ 1 が平面視で仮想の長方形 V S の第 1 辺 E 1 および第 3 辺 E 3 に接するとともに、ヘッドチップ 5 4 __ 2 が平面視で第 2 辺 E 2 に接する。そして、平面視で第 1 辺 E 1 と第 2 辺 E 2 とヘッドチップ 5 4 __ 1 とヘッドチップ 5 4 __ 2 とで囲まれる第 1 領域 R E 1 は、保持部 5 a 1 の外縁 O E 1 よりも外側に位置する第 1 外側部分 R E 1 b を含む。なお、外縁 O E 1 は、平面視での側壁部 5 a 1 2 の外縁である。

【 0 1 1 0 】

なお、長方形 V S は、前述のように、平面視で、液体噴射ヘッド 5 0 の有する複数のヘッドチップ 5 4 の集合体に外接する。第 1 辺 E 1 は、長方形 V S の 4 つの辺のうちの 1 つの辺である。第 2 辺 E 2 は、長方形 V S の 4 つの辺のうちの第 1 辺 E 1 の一端に接続される辺である。第 3 辺 E 3 は、長方形 V S の 4 つの辺のうちの第 1 辺 E 1 の他端に接続される辺である。

20

【 0 1 1 1 】

第 1 外側部分 R E 1 b には、保持部 5 a 1 が存在しないし、ヘッドチップ 5 4 も存在しない。したがって、このような第 1 外側部分 R E 1 b が存在することは、保持部 5 a 1 の加熱すべき部分以外の無駄な部分を少なくすることを意味する。このため、ヒーター 5 6 からの熱が当該無駄な部分に逃げることを低減することができ、この結果、ヘッドチップ 5 4 をヒーター 5 6 により効率的に加熱することができる。また、ヒーター 5 6 の小面積化または省電力化を図れるという利点もある。

【 0 1 1 2 】

前述のように、ホルダー 5 3 には、複数のインク孔 5 3 b が設けられており、当該複数のインク孔 5 3 b は、複数のヘッドチップ 5 4 に供給されるインクの流路を構成する。したがって、ホルダー 5 3 のインクに対する耐性を高めたり、ホルダー 5 3 を介してヒーター 5 6 からの熱をインク孔 5 3 b 内のインクへ効率的に伝達したりする観点から、ホルダー 5 3 は、ステンレス鋼またはセラミックスで構成されることが好ましい。

30

【 0 1 1 3 】

また、平面視で、第 1 領域 R E 1 は、ヒーター 5 6 に重ならない第 1 外側部分 R E 1 d を含む。このため、ヒーター 5 6 の小面積化を図ることができる。第 1 外側部分 R E 1 d には、ヘッドチップ 5 4 __ 1 およびヘッドチップ 5 4 __ 2 が存在しないので、ヒーター 5 6 の無駄な発熱を低減することができる。この結果、ヘッドチップ 5 4 をヒーター 5 6 により効率的に加熱することができる。

40

【 0 1 1 4 】

さらに、前述のように、液体噴射ヘッド 5 0 は、「第 2 伝熱部材」の一例である伝熱部材 5 7 をさらに備える。伝熱部材 5 7 は、ヒーター 5 6 と流路構造体 5 1 との間に配置され、流路構造体 5 1 よりも熱伝導率の高い部材であり、例えばアルミニウムである。そして、平面視で、伝熱部材 5 7 および流路構造体 5 1 のそれぞれは、第 1 外側部分 R E 1 b に重なる。流路構造体 5 1 が第 1 外側部分 R E 1 b に存在することにより、流路構造体 5 1 内の流路の引き回しの自由度を高めることができる。また、伝熱部材 5 7 がヒーター 5 6 と流路構造体 5 1 との間に配置されるので、ヒーター 5 6 からの熱を第 2 伝熱部材で面方向に拡げた後に流路構造体 5 1 に伝達することができる。特に、第 1 外側部分 R E 1 b

50

に流路構造体 5 1 が存在する部分を有しても、伝熱部材 5 7 も第 1 外側部分 R E 1 b に存在するので、伝熱部材 5 7 を介してヒーター 5 6 からの熱を当該部分に伝達することができる。この結果、ヒーター 5 6 による流路構造体 5 1 の温度分布のバラつきを低減することができる。

【 0 1 1 5 】

また、前述のように、流路構造体 5 1 のインクに対する耐性を高めたり、ヒーター 5 6 からの熱を流路構造体 5 1 内のインクへ効率的に伝達したりする観点から、流路構造体 5 1 は、ステンレス鋼またはセラミックスで構成されることが好ましい。

【 0 1 1 6 】

また、本実施形態では、複数のヘッドチップ 5 4 は、「第 3 ヘッドチップ」の一例であるヘッドチップ 5 4 __ 3 と、「第 4 ヘッドチップ」の一例であるヘッドチップ 5 4 __ 4 と、を含む。ヘッドチップ 5 4 __ 3 およびヘッドチップ 5 4 __ 4 は、Y 軸に沿う方向および X 軸に沿う方向の双方に互いにずれて配置される。

10

【 0 1 1 7 】

ここで、仮想の長方形 V S の 4 つの辺のうち、第 1 辺 E 1、第 2 辺 E 2 および第 3 辺 E 3 以外の辺を第 4 辺 E 4 としたとき、ヘッドチップ 5 4 __ 3 が平面視で第 3 辺 E 3 に接するとともに、ヘッドチップ 5 4 __ 4 が平面視で第 2 辺 E 2 および第 4 辺 E 4 に接する。そして、平面視で第 3 辺 E 3 と第 4 辺 E 4 とヘッドチップ 5 4 __ 3 とヘッドチップ 5 4 __ 4 とで囲まれる第 2 領域 R E 2 は、保持部 5 a 1 の外縁 O E 1 よりも外側に位置する第 2 外側部分 R E 2 b を含む。

20

【 0 1 1 8 】

第 2 外側部分 R E 2 b には、前述の第 1 外側部分 R E 1 b と同様、保持部 5 a 1 が存在しないし、ヘッドチップ 5 4 も存在しない。したがって、このような第 2 外側部分 R E 2 b が存在することは、保持部 5 a 1 の加熱すべき部分以外の無駄な部分を少なくすることを意味する。このため、ヒーター 5 6 からの熱が当該無駄な部分に逃げることを低減することができる。この結果、ヘッドチップ 5 4 をヒーター 5 6 により効率的に加熱することができる。また、ヒーター 5 6 の小面積化または省電力化を図れるという利点もある。

【 0 1 1 9 】

第 1 外側部分 R E 1 b の面積は、第 1 領域 R E 1 の面積の $1/4$ 以上であることが好ましく、第 1 領域 R E 1 の面積の $1/2$ 以上 $9/10$ 以下であることがより好ましい。第 1 外側部分 R E 1 b の面積がこのような範囲内であると、保持部 5 a 1 の前述のような無駄な部分を好適に少なくすることができる。これに対し、第 1 外側部分 R E 1 b の面積が小さすぎると、ヒーター 5 6 の消費電力が増大したり、各ヘッドチップ 5 4 内または複数のヘッドチップ 5 4 間の温度分布のばらつきが生じやすくなったりする傾向を示す。一方、第 1 外側部分 R E 1 b の面積が大きすぎると、保持部 5 a 1 に必要な肉厚を確保することが難しい。なお、第 2 外側部分 R E 2 b の面積も、第 1 外側部分 R E 1 b の面積と第 1 領域 R E 1 との関係と同様、第 2 領域 R E 2 の面積の $1/4$ 以上であることが好ましい。

30

【 0 1 2 0 】

また、前述のように、ヒーター 5 6 は、平面視で複数のヘッドチップ 5 4 に重なる。そして、平面視で前述の第 1 領域 R E 1 は、ヒーター 5 6 の外縁 O E 2 よりも外側に位置する第 1 外側部分 R E 1 d を含む。

40

【 0 1 2 1 】

第 1 外側部分 R E 1 d には、ヒーター 5 6 が存在しないし、ヘッドチップ 5 4 も存在しない。したがって、このような第 1 外側部分 R E 1 d が存在することは、ヒーター 5 6 の不要な部分を少なくすることを意味する。このため、当該不要な部分の発熱に起因する各ヘッドチップ 5 4 内または複数のヘッドチップ 5 4 間での温度分布のばらつきを低減することができる。また、ヒーター 5 6 の小面積化または省電力化を図れるという利点もある。

【 0 1 2 2 】

ここで、平面視で、前述の伝熱部材 5 7 および流路構造体 5 1 のそれぞれは、第 1 外側部分 R E 1 d に重なる。流路構造体 5 1 が第 1 外側部分 R E 1 d に存在することにより、

50

流路構造体 5 1 内の流路の引き回しの自由度を高めることができる。また、第 1 外側部分 R E 1 d に流路構造体 5 1 が存在する部分を有しても、伝熱部材 5 7 も第 1 外側部分 R E 1 d に存在するので、伝熱部材 5 7 を介してヒーター 5 6 からの熱を当該部分に伝達することができる。この結果、ヒーター 5 6 による流路構造体 5 1 の温度分布のバラつきを低減することができる。なお、平面視で、流路構造体 5 1 内の流路の一部が第 1 外側部分 R E 1 d と重複する構成では特に有用である。

【 0 1 2 3 】

また、前述のように、平面視で前述の第 2 領域 R E 2 は、ヒーター 5 6 の外縁 O E 2 よりも外側に位置する第 2 外側部分 R E 2 d を含む。

【 0 1 2 4 】

第 2 外側部分 R E 2 d には、前述の第 1 外側部分 R E 1 d と同様、ヒーター 5 6 が存在しないし、ヘッドチップ 5 4 も存在しない。したがって、このような第 2 外側部分 R E 2 d が存在することは、ヒーター 5 6 の不要な部分を少なくすることを意味する。このため、当該不要な部分の発熱に起因する各ヘッドチップ 5 4 内または複数のヘッドチップ 5 4 間での温度分布のばらつきを低減することができる。また、ヒーター 5 6 の小面積化または省電力化を図れるという利点もある。

【 0 1 2 5 】

第 1 外側部分 R E 1 d の面積は、第 1 領域 R E 1 の面積の $1/4$ 以上であることが好ましく、第 1 領域 R E 1 の面積の $1/2$ 以上 $9/10$ 以下であることがより好ましい。第 1 外側部分 R E 1 d の面積がこのような範囲内であると、ヒーター 5 6 の不要な部分を好適に少なくすることができる。これに対し、第 1 外側部分 R E 1 d の面積が小さすぎると、ヒーター 5 6 の消費電力が増大したり、各ヘッドチップ 5 4 内または複数のヘッドチップ 5 4 間の温度分布のばらつきが生じやすくなったりする傾向を示す。一方、第 1 外側部分 R E 1 d の面積が大きすぎると、保持部 5 a 1 の大きさ等によっては、ヒーター 5 6 からの熱を保持部 5 a 1 に均一に伝達することが難しく、この点でも、各ヘッドチップ 5 4 内または複数のヘッドチップ 5 4 間の温度分布のばらつきが生じやすくなる傾向を示す。なお、第 2 外側部分 R E 2 d の面積も、第 1 外側部分 R E 1 d の面積と第 1 領域 R E 1 との関係と同様、第 2 領域 R E 2 の面積の $1/4$ 以上であることが好ましい。

【 0 1 2 6 】

また、前述のように、液体噴射ヘッド 5 0 は、支持体 4 1 に支持される。ここで、ホルダー 5 3 は、保持部 5 a 1 のほか、保持部 5 a 1 から離れた位置で支持体 4 1 と接触するフランジ部 5 c を有する。ヒーター 5 6 は、保持部 5 a 1 を加熱する。保持部 5 a 1 は、ヒーター 5 6 からの熱を受ける受熱部 5 a 1 1 を有する。

【 0 1 2 7 】

そのうえで、伝達経路 H 2 のうち受熱部 5 a 1 1 からフランジ部 5 c までホルダー 5 3 を伝わる熱の最短経路は、2 か所以上で屈曲または湾曲する。ここで、屈曲または湾曲とは、例えば本実施形態のように側壁部 5 a 1 2 と接続部 5 a 2 との間で屈曲または湾曲されている場合に、側壁部 5 a 1 2 の伝達経路 H 2 に沿う長さ（換言すれば、Z 軸に沿う方向に関する側壁部 5 a 1 2 の長さ）及び接続部 5 a 2 の伝達経路 H 2 に沿う長さ（換言すれば、Y 軸に沿う方向に関する接続部 5 a 2 の長さ）の夫々が、側壁部 5 a 1 2 の厚さ方向（Y 軸に沿う方向）の厚みよりも長く、接続部 5 a 2 の厚さ方向（Z 軸に沿う方向）の厚みよりも長い状態をいう。これは、接続部 5 a 2 と外壁部 5 b との間の屈曲または湾曲でも同じであり、これらの部分以外で屈曲または湾曲されている場合でも同じである。なお、「当該受熱部 5 a 1 1 からフランジ部 5 c までの最短経路」は、受熱部 5 a 1 1 及びフランジ部 5 c の内部を移動する熱の経路を含めてはいない。より詳述すれば、「当該受熱部 5 a 1 1 からフランジ部 5 c までの最短経路」は、受熱部 5 a 1 1 の任意の位置から、フランジ部 5 c と支持体 4 1 との接触位置まで、ホルダー 5 3 内を通る最短の経路のうち、受熱部 5 a 1 1 及びフランジ部 5 c の内部を移動する熱の経路を含めない部分である。このため、当該受熱部 5 a 1 1 からフランジ部 5 c までの最短経路が直線状である構成や、接続部 5 a 2 の Z 1 方向を向く面を第 1 面 F 1 に一致させるように接続部 5 a 2 の厚

10

20

30

40

50

さを厚くした構成に比べて、当該最短経路の熱抵抗を高めることができる。したがって、ヒーター 5 6 からの熱がフランジ部 5 c を介して支持体 4 1 に放熱し難くすることができる。この結果、ヘッドチップ 5 4 をヒーター 5 6 により効率的に加熱することができる。

【 0 1 2 8 】

ここで、前述のように、ヒーター 5 6 は、保持部 5 a 1 に対してノズル面 F N の法線方向 (Z 2 方向) とは反対方向 (Z 1 方向) の位置に配置される。そして、保持部 5 a 1 は、受熱部 5 a 1 1 から当該法線方向 (Z 2 方向) に延びる側壁部 5 a 1 2 をさらに有する。受熱部 5 a 1 1 および側壁部 5 a 1 2 は、ヘッドチップ 5 4 を収容する「空間」の一例である凹部 5 3 d を形成する。このため、ヘッドチップ 5 4、ホルダー 5 3、ヒーター 5 6 をこの順で積層するように容易に組み立てることができる。

10

【 0 1 2 9 】

そのうえで、ホルダー 5 3 は、フランジ部 5 c に接続されるとともに当該法線方向にみて側壁部 5 a 1 2 を囲む外壁部 5 b と、側壁部 5 a 1 2 と外壁部 5 b とを接続する接続部 5 a 2 と、をさらに有する。そして、接続部 5 a 2 は、当該法線方向に交差する方向に延びており、側壁部 5 a 1 2 および外壁部 5 b のそれぞれは、接続部 5 a 2 から当該法線方向とは反対方向に延びる。

【 0 1 3 0 】

このように、ホルダー 5 3 は、ヘッドチップ 5 4 を保持する保持部 5 a 1 と、保持部 5 a 1 から離れた位置で支持体 4 1 と接触するフランジ部 5 c と、フランジ部 5 c に接続されるとともにノズル面 F N の法線方向にみて保持部 5 a 1 を囲む外壁部 5 b と、保持部 5 a 1 と外壁部 5 b とを接続する接続部 5 a 2 と、を有する。そして、保持部 5 a 1 が接続部 5 a 2 から当該法線方向とは反対方向に突出するとともに、外壁部 5 b が接続部 5 a 2 からフランジ部 5 c に向けて当該法線方向とは反対方向に延びる。

20

【 0 1 3 1 】

このようにホルダー 5 3 を構成することにより、伝達経路 H 2 のうち受熱部 5 a 1 1 からフランジ部 5 c までの最短経路は、側壁部 5 a 1 2 と接続部 5 a 2 との接続により屈曲または湾曲する箇所と、外壁部 5 b と接続部 5 a 2 との接続により屈曲または湾曲する箇所と、を有する。つまり、伝達経路 H 2 のうち受熱部 5 a 1 1 からフランジ部 5 c までの最短経路において側壁部 5 a 1 2 での熱の伝達方向と外壁部 5 b での熱の伝達方向とが互いに反対方向である。

30

【 0 1 3 2 】

また、外壁部 5 b は、前述のように、平面視で保持部 5 a 1 との間に間隔を隔てて保持部 5 a 1 を囲む。このため、受熱部 5 a 1 1 からフランジ部 5 c までの間で前述のような 2 か所以上で屈曲または湾曲する伝達経路 H 2 を容易に実現することができる。

【 0 1 3 3 】

さらに、前述のように、フランジ部 5 c は、受熱部 5 a 1 1 よりもノズル面 F N の法線方向とは反対方向の位置に配置される。このため、外壁部 5 d の Z 軸に沿う方向に関して長尺化することができ、伝達経路 H 2 の熱抵抗を高くすることができる。

【 0 1 3 4 】

また、前述のように、受熱部 5 a 1 1 は、互いに反対方向を向く第 1 面 F 1 および第 2 面 F 2 を有する。ここで、第 1 面 F 1 は、ヒーター 5 6 からの熱を受ける受熱面である。ヘッドチップ 5 4 は、インクの流路が設けられたケース 5 4 h を有する。ケース 5 4 h は、第 2 面 F 2 に固定され、ホルダー 5 3 よりも熱伝導率の低い材料で構成される。このように、ケース 5 4 h の構成材料の熱伝導率をホルダー 5 3 よりも低くすることにより、ヘッドチップ 5 4 内のインクからの放熱を低減することができる。ここで、受熱部 5 a 1 1 からの熱は、ケース 5 4 h に伝わり難くなる結果、相対的に支持体 4 1 に向かう方向にホルダー 5 3 を伝って移動しやすくなる。したがって、このようなケース 5 4 h を用いる場合、前述のように支持体 4 1 から放熱し難くすることは、特に有用である。

40

【 0 1 3 5 】

さらに、前述のように、流路構造体 5 1 は、保持部 5 a 1 に対してノズル面 F N の法線

50

方向とは反対方向の位置に配置されており、ヒーター５６は、保持部５ａ１と流路構造体５１との間に配置される。そして、流路構造体５１は、外壁部５ｂとの間に間隔を隔てて配置される。このため、流路構造体５１から外壁部５ｂへの直接的な放熱を低減することができる。

【０１３６】

また、前述のように、ノズル面ＦＮの法線方向にみて側壁部５ａ１２の外周面は、外壁部５ｂの内周面に対して全域にわたり間隔を隔てて配置される。このため、側壁部５ａ１２から外壁部５ｂへの直接的な放熱を低減することができる。

【０１３７】

さらに、前述のように、フランジ部５ｃは、ノズル面ＦＮの法線方向にみて外壁部５ｂを全周にわたり囲む。このため、ヘッドチップ５４でのインクの噴射に伴って発生するミストがノズル面ＦＮから支持体４１よりも鉛直上方に回り込むのをフランジ部５ｃにより阻止することができる。一方、フランジ部５ｃは、ヒーター５６の熱が外壁部５ｂを囲むフランジ部５ｃの全周から支持体４１へ放熱される虞が有るが、前述のようにノズル面ＦＮの法線方向にみて側壁部５ａ１２の外周面は、外壁部５ｂの内周面に対して全域にわたり間隔を隔てて配置されるため、側壁部５ａ１２から外壁部５ｂへの直接的な放熱を低減することができる。

【０１３８】

２．第２実施形態

以下、本発明の第２実施形態について説明する。以下に例示する形態において作用や機能が第１実施形態と同様である要素については、第１実施形態の説明で使用した符号を流用して各々の詳細な説明を適宜に省略する。

【０１３９】

図１２は、第２実施形態に係る液体噴射ヘッド５０Ａの分解斜視図である。液体噴射ヘッド５０Ａは、ヒーター５６および伝熱部材５７の配置が異なる以外は、前述の第１実施形態の液体噴射ヘッド５０と同様である。

【０１４０】

図１２に示すように、本実施形態では、Ｚ軸に沿う方向でのヒーター５６および伝熱部材５７の並び順が前述の第１実施形態と逆である。すなわち、液体噴射ヘッド５０Ａでは、Ｚ２方向に向かって、カバー５８、基板ユニット５２、流路構造体５１、ヒーター５６、伝熱部材５７、ホルダー５３、４個のヘッドチップ５４、固定板５５の順に、これらが並ぶように配置される。本実施形態の伝熱部材５７は、「第１伝熱部材」の一例である。

【０１４１】

以上の第２実施形態によっても、前述の第１実施形態と同様、ヘッドチップ５４の温度を高精度に管理することができる。図１３に示す例では、流路構造体５１、ヒーター５６および伝熱部材５７の平面視形状は、前述の第１実施形態と同様である。つまり、平面視で、伝熱部材５７は、第１外側部分ＲＥ１ｂに重なる。また、平面視でヒーター５６および流路構造体５１のそれぞれが第１外側部分ＲＥ１ｂに重なる場合、ヒーター５６からの熱を無駄なく保持部５ａ１に伝達することができる。

【０１４２】

ただし、ヒーター５６の平面視形状は、これに限定されず、例えば、流路構造体５１または伝熱部材５７の平面視形状と同じでもよい。すなわち、平面視で、ヒーター５６および流路構造体５１のそれぞれは、第１外側部分ＲＥ１ｂに重なってもよい。この場合、ヒーター５６と流路構造体５１との間に伝熱部材５７が存在しなくても、流路構造体５１の温度分布のバラつきを低減することができる。

【０１４３】

３．第３実施形態

以下、本発明の第３実施形態について説明する。以下に例示する形態において作用や機能が第１実施形態と同様である要素については、第１実施形態の説明で使用した符号を流用して各々の詳細な説明を適宜に省略する。

【 0 1 4 4 】

図 1 3 は、第 3 実施形態におけるヒーター 5 6 からの熱の伝達経路 H 1 および伝達経路 H 2 を説明するための図である。本実施形態の液体噴射ヘッド 5 0 B は、ホルダー 5 3 に代えてホルダー 5 3 B を有する以外は、前述の第 1 実施形態の液体噴射ヘッド 5 0 と同様である。ホルダー 5 3 B は、外壁部 5 b に代えて外壁部 5 d を有する以外は、ホルダー 5 3 と同様である。

【 0 1 4 5 】

外壁部 5 d は、底部 5 a の接続部 5 a 2 の外周縁とフランジ部 5 c の内周縁とを接続する。ここで、外壁部 5 d は、第 1 壁部 5 d 1 と第 1 板部 5 d 2 と第 2 壁部 5 d 3 と第 2 板部 5 d 4 と第 3 壁部 5 d 5 とを有する。

10

【 0 1 4 6 】

第 1 壁部 5 d 1 は、接続部 5 a 2 から Z 1 方向に延びる筒状をなす。第 1 板部 5 d 2 は、保持部 5 a 1 に近づくよう第 1 壁部 5 d 1 から Z 軸に直交する方向に延びる板状をなす。第 2 壁部 5 d 3 は、第 1 板部 5 d 2 から Z 1 方向に延びる筒状をなす。第 2 板部 5 d 4 は、保持部 5 a 1 から遠ざかるよう第 2 壁部 5 d 3 から Z 軸に直交する方向に延びる板状をなす。第 3 壁部 5 d 5 は、第 2 板部 5 d 4 から Z 1 方向に延びる筒状をなす。

【 0 1 4 7 】

以上の第 3 実施形態によっても、前述の第 1 実施形態と同様、ヘッドチップ 5 4 の温度を高精度に管理することができる。本実施形態では、前述のような外壁部 5 d を介して底部 5 a とフランジ部 5 c とが接続されるので、ヒーター 5 6 から支持体 4 1 への熱の伝達経路 H 2 は、少なくとも 6 箇所て屈曲または湾曲する。図 1 3 では、伝達経路 H 2 の屈曲または湾曲する 6 箇所が二点鎖線で囲まれる領域で示される。このように伝達経路 H 2 の屈曲または湾曲する箇所の数が 4 以上であると、前述の第 1 実施形態に比べて、伝達経路 H 2 の熱抵抗を高めやすいという利点がある。なお、前述の第 1 実施形態と同様、「当該受熱部 5 a 1 1 からフランジ部 5 c までの最短経路」は、受熱部 5 a 1 1 及びフランジ部 5 c の内部を移動する熱の経路を含めてはいない。

20

【 0 1 4 8 】

4 . 変形例

以上に例示した形態は多様に変形され得る。前述の形態に適用され得る具体的な変形の態様を以下に例示する。以下の例示から任意に選択された 2 以上の態様は、相互に矛盾しない範囲で適宜に併合され得る。

30

【 0 1 4 9 】

4 - 1 . 変形例 1

前述の形態では、保持部 5 a 1 の平面視形状が 4 個のヘッドチップ 5 4 の配置に応じて長方形とは異なる形状である。保持部 5 a 1 の平面視形状は、前述の形態に限定されず、例えば、長方形または略長方形でもよい。

【 0 1 5 0 】

4 - 2 . 変形例 2

前述の形態では、ヒーター 5 6 の平面視形状が 4 個のヘッドチップ 5 4 の配置に応じて長方形とは異なる形状である。ヒーター 5 6 の平面視形状は、前述の形態に限定されず、例えば、長方形または略長方形でもよい。

40

【 0 1 5 1 】

4 - 3 . 変形例 3

前述の形態では、1 個の伝熱部材 5 7 を用いる構成が例示されるが、当該構成に限定されず、例えば、第 1 実施形態および第 2 実施形態を組み合わせたような形態でもよい。すなわち、ヒーター 5 6 とホルダー 5 3 との間と、ヒーター 5 6 と流路構造体 5 1 との間と、のそれぞれに伝熱部材 5 7 を配置してもよい。

【 0 1 5 2 】

4 - 4 . 変形例 4

ともに剛体であるホルダー 5 3 と流路構造体 5 1 との間には、弾性シートを配置しても

50

よい。このような弾性シートとしては、エラストマーなどが採用でき、例えばヘッドチップ54のケース54hを構成する樹脂材料よりも熱伝導率の高い熱伝導シートが選択されることが望ましい。このような樹脂材料よりも熱伝導率の高い弾性の熱伝導シートとしては、熱伝導率が1.0以上 $W/m \cdot K$ 以上である材料を用いるのが好ましい。具体的に熱伝導シートとしては、アクリル系又はシリコン系のシートや、エラストマーにシリコン、ステンレス鋼、アルミニウム、チタンおよびマグネシウム合金等の金属材料を分散させた材料、炭素繊維などカーボン系やシリカやアルミナ等のセラミック酸化物又は窒化ケイ素や窒化ホウ素等のセラミック窒化物等のフィラーをエラストマー等の弾性材料に含有させた複合材料などが好適である。このようにホルダー53と流路構造体51との隙間を弾性材料で埋めることで、ホルダー53や流路構造体51のZ軸に沿う方向に関する厚さ寸法に製造誤差が生じたとしても、伝熱部材57やヒーター56と、ホルダー53や流路構造体51のような加熱対象物との密着性を高めて、ヒーター56からの熱を当該加熱対象物に効率的に伝達することができる。

10

【0153】

4-5. 変形例5

前述の実施形態における「ヒーター56の外縁OE2」は、ヒーター56の有する発熱抵抗体の形成領域の外縁に読み替えられてよい。

【0154】

4-6. 変形例6

平面視で、ヒーター56は、第1外側部分RE1bに重ならなくてもよい。この構成では、ヒーター56の小面積化を図ることができる。また、第1外側部分RE1bには、ヘッドチップ54__1、ヘッドチップ54__2および保持部5a1が存在しないので、平面視でヒーター56が第1外側部分RE1bに重ならないことにより、ヒーター56の無駄な発熱をより低減することができる。

20

【0155】

4-7. 変形例7

前述の形態では、液体噴射ヘッド50の有するヘッドチップ54の数が4個である構成が例示されるが、当該構成に限定されず、当該数は、2個、3個または5個以上でもよい。また、前述の形態では、複数のヘッドチップ54が、ヘッドチップ54の長手方向に沿って千鳥状に配置されていたが、当該構成に限定されず、複数のヘッドチップ54は、ヘッドチップ54の短手方向に沿って千鳥状に配置されてもよい。

30

【0156】

4-8. 変形例8

前述の形態では、液体噴射ヘッド50を支持する支持体41を往復させるシリアル方式の液体噴射装置100が例示されるが、複数のノズルNが媒体Mの全幅にわたり分布するライン方式の液体吐出装置にも本発明を適用することが可能である。すなわち、液体噴射ヘッド50を支持する支持体は、シリアル方式のキャリッジに限定されず、ライン方式において液体噴射ヘッド50を支持する構造体でもよい。この場合、例えば、複数の液体噴射ヘッド50が媒体Mの幅方向に並んで配置され、当該複数の液体噴射ヘッド50が1つの支持体に一括して支持される。

40

【0157】

4-9. 変形例9

前述の形態で例示した液体噴射装置は、印刷に専用される機器のほか、ファクシミリ装置やコピー機等の各種の機器に採用され得る。もっとも、液体噴射装置の用途は印刷に限定されない。例えば、色材の溶液を噴射する液体噴射装置は、液晶表示パネル等の表示装置のカラーフィルターを形成する製造装置として利用される。また、導電材料の溶液を噴射する液体噴射装置は、配線基板の配線や電極を形成する製造装置として利用される。また、生体に関する有機物の溶液を噴射する液体噴射装置は、例えばバイオチップを製造する製造装置として利用される。

【符号の説明】

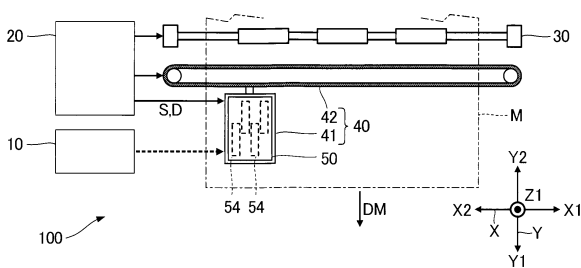
50

【 0 1 5 8 】

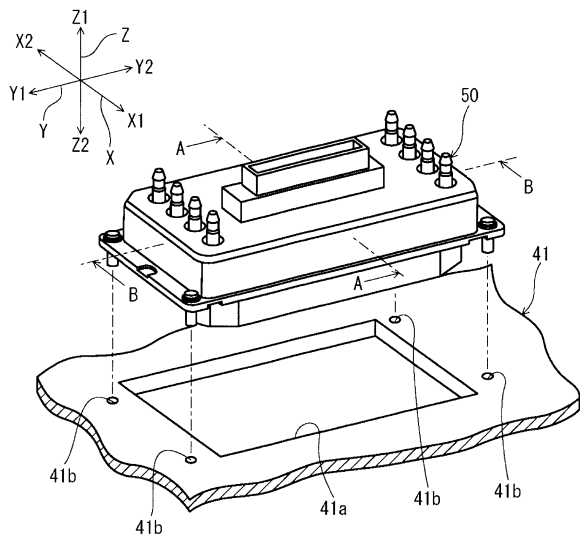
5 a ... 底部、5 a 1 ... 保持部、5 a 1 1 ... 受熱部、5 a 1 2 ... 側壁部、5 a 2 ... 接続部、5 b ... 外壁部、5 c ... フランジ部、5 c 1 ... 取付面、5 d ... 外壁部、5 d 1 ... 第 1 壁部、5 d 2 ... 第 1 板部、5 d 3 ... 第 2 壁部、5 d 4 ... 第 2 板部、5 d 5 ... 第 3 壁部、1 0 ... 液体貯留部、2 0 ... 制御ユニット、3 0 ... 搬送機構、4 0 ... 移動機構、4 1 ... 支持体、4 1 a ... 開口、4 1 b ... ネジ孔、4 2 ... 搬送ベルト、5 0 ... 液体噴射ヘッド、5 0 A ... 液体噴射ヘッド、5 0 B ... 液体噴射ヘッド、5 1 ... 流路構造体、5 1 a ... 流路部材、5 1 b ... 接続管、5 1 c ... 配線孔、5 2 ... 基板ユニット、5 2 a ... 回路基板、5 2 b ... コネクター、5 2 c ... 支持板、5 3 ... ホルダー、5 3 B ... ホルダー、5 3 a ... 凹部、5 3 b ... インク孔、5 3 c ... 配線孔、5 3 d ... 凹部、5 3 e ... 孔、5 3 f ... 孔、5 3 g ... ネジ孔、5 3 h ... 凹部、5 3 i ... ネジ孔、5 3 j ... 孔、5 3 k ... ネジ孔、5 3 l ... 流路管、5 4 ... ヘッドチップ、5 4 _ 1 ... ヘッドチップ (第 1 ヘッドチップ)、5 4 _ 2 ... ヘッドチップ (第 2 ヘッドチップ)、5 4 _ 3 ... ヘッドチップ (第 3 ヘッドチップ)、5 4 _ 4 ... ヘッドチップ (第 4 ヘッドチップ)、5 4 a ... 流路基板、5 4 b ... 圧力室基板、5 4 c ... ノズル板、5 4 d ... 吸振体、5 4 e ... 振動板、5 4 f ... 圧電素子、5 4 g ... 保護板、5 4 h ... ケース、5 4 i ... 配線基板、5 4 j ... 駆動回路、5 4 k ... 枠体、5 5 ... 固定板、5 5 a ... 開口部、5 6 ... ヒーター、5 6 a ... 孔、5 6 b ... 孔、5 7 ... 伝熱部材、5 7 a ... 孔、5 7 b ... 配線孔、5 7 c ... 孔、5 8 ... カバー、5 8 a ... 貫通孔、5 8 b ... 開口部、1 0 0 ... 液体噴射装置、C ... 圧力室、C P ... 中心、D ... 駆動信号、D M ... 搬送方向、E 1 ... 第 1 辺、E 2 ... 第 2 辺、E 3 ... 第 3 辺、E 4 ... 第 4 辺、F 1 ... 第 1 面、F 2 ... 第 2 面、F N ... ノズル面、H 1 ... 伝達経路、H 2 ... 伝達経路 (最短経路)、I O ... 導入口、I P a ... 交点、I P b ... 交点、I P c ... 交点、I P d ... 交点、L 1 ... 第 1 列、L 2 ... 第 2 列、M ... 媒体、M P 1 ... 中点、M P 2 ... 中点、N ... ノズル、N a ... 連通流路、O E 1 ... 外縁、O E 2 ... 外縁、P A 1 ... 第 1 部分、P A 2 ... 第 2 部分、R ... リザーバー、R 1 ... 空間、R 2 ... 空間、R E 1 ... 第 1 領域、R E 1 a ... 第 1 内側部分、R E 1 b ... 第 1 外側部分、R E 1 c ... 第 1 内側部分、R E 1 d ... 第 1 外側部分、R E 2 ... 第 2 領域、R E 2 a ... 第 2 内側部分、R E 2 b ... 第 2 外側部分、R E 2 c ... 第 2 内側部分、R E 2 d ... 第 2 外側部分、R a ... 供給流路、S ... 制御信号、V S ... 長方形。

【 図面 】

【 図 1 】



【 図 2 】



10

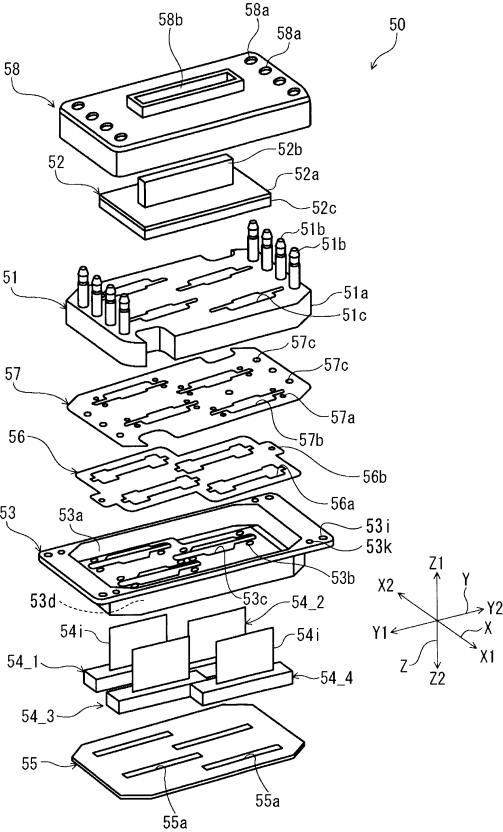
20

30

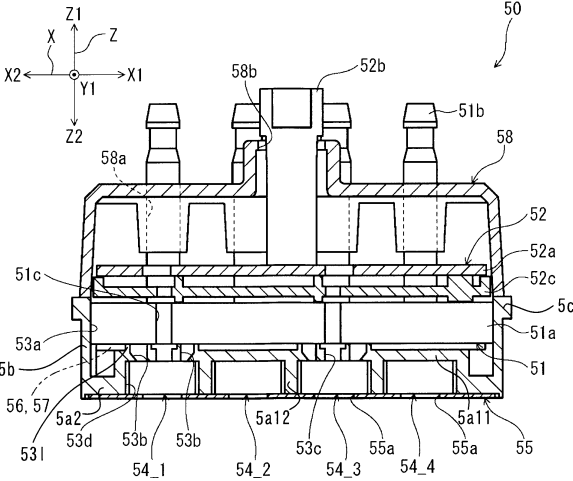
40

50

【図 3】



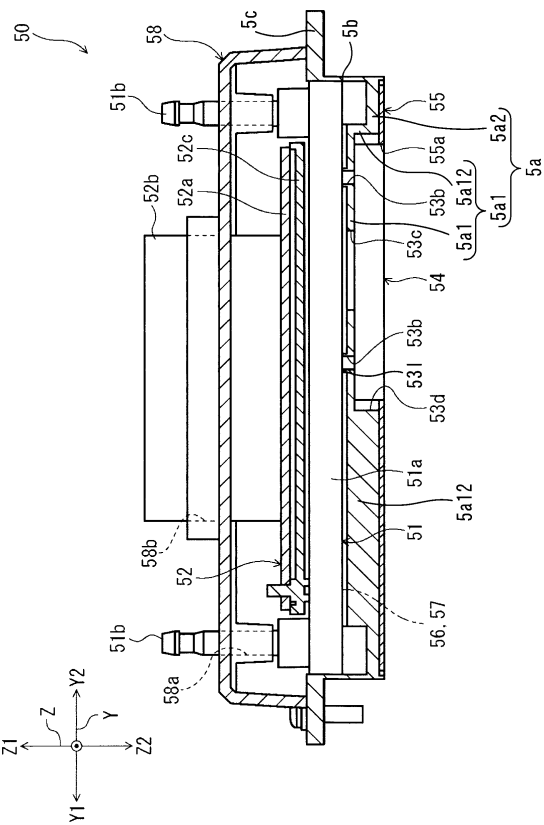
【図 4】



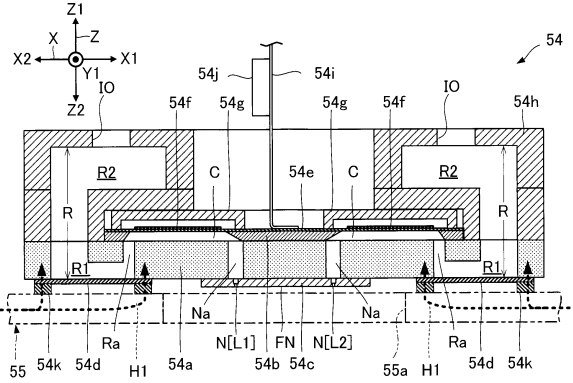
10

20

【図 5】



【図 6】

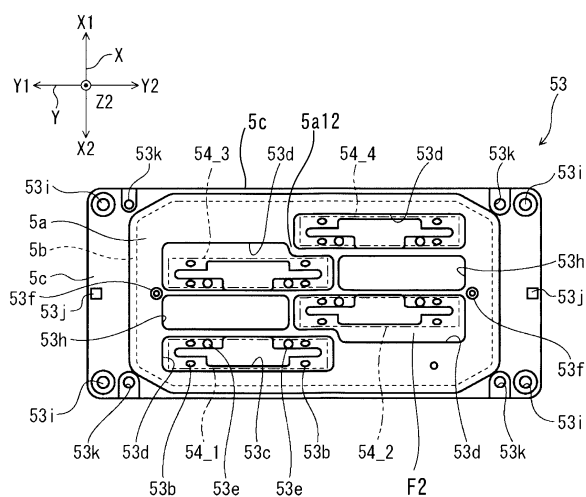


30

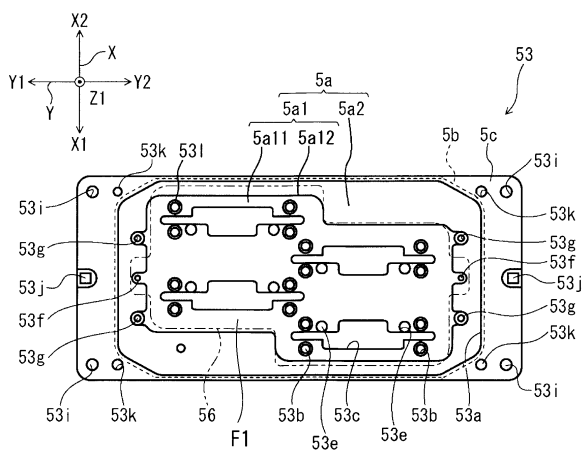
40

50

【 図 7 】

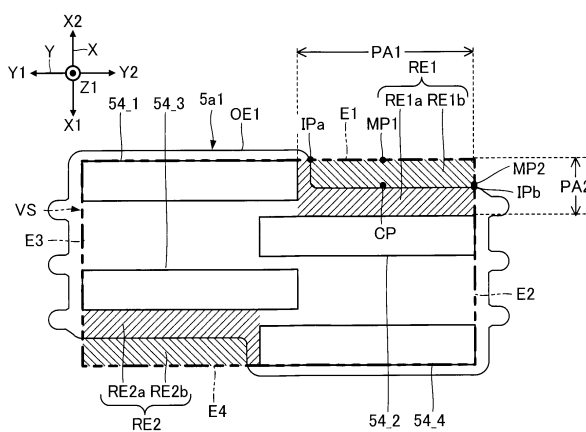


【圖 8】

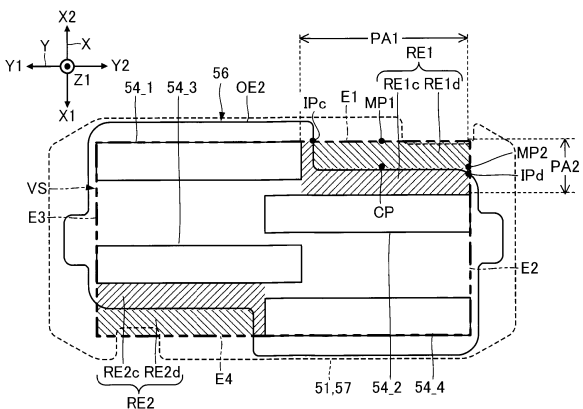


10

【 図 9 】



【 図 1 0 】



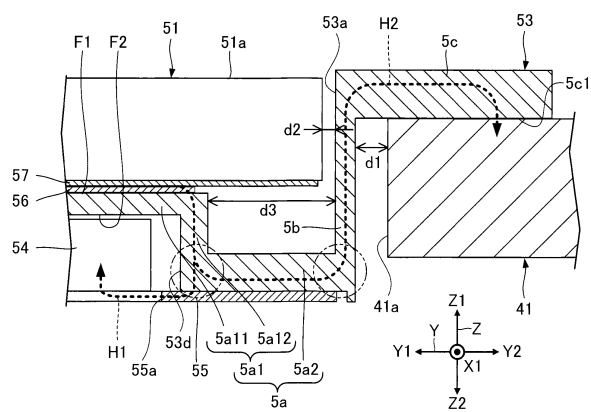
20

30

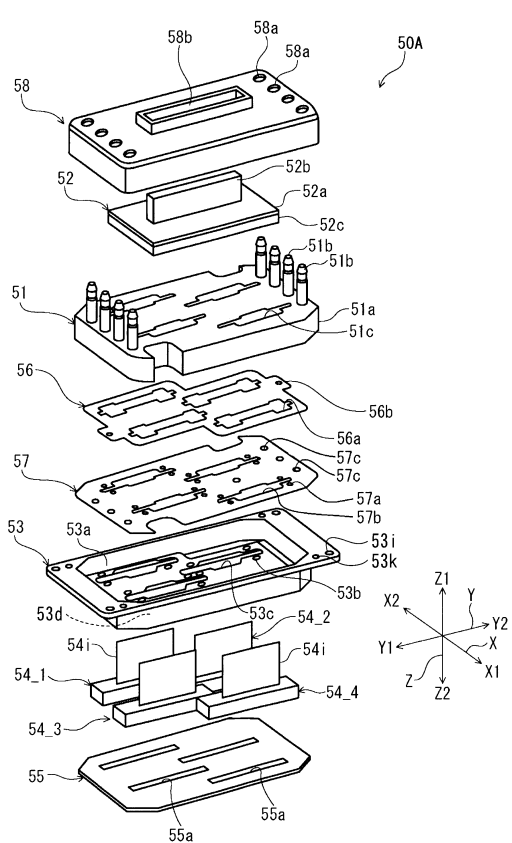
40

50

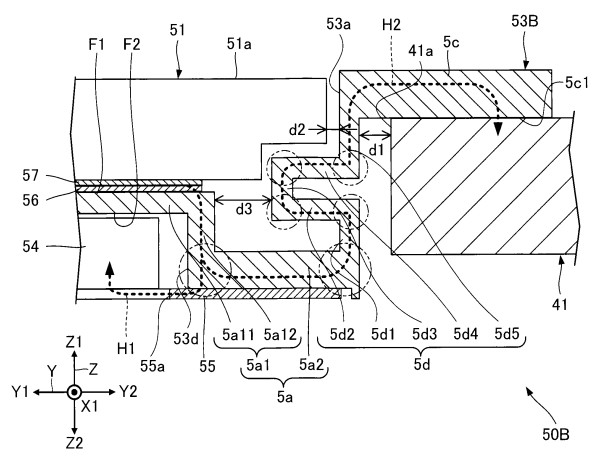
【 图 1 1 】



【圖 1 2】



【圖 13】



フロントページの続き

- 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内
- (72)発明者 小林 大記
- 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内
- (72)発明者 植澤 晴久
- 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内
- 審査官 高松 大治
- (56)参考文献 特開2019-188716(JP,A)
- 特開2015-163438(JP,A)
- 特開2010-076176(JP,A)
- 特開2015-217516(JP,A)
- 特開2017-019153(JP,A)
- 特開2008-037075(JP,A)
- 特開2010-269450(JP,A)
- 米国特許出願公開第2008/0303853(US,A1)
- (58)調査した分野 (Int.Cl., DB名)
- B41J 2/01-2/215